



股票代號：7853

政美應用股份有限公司
Cheng Mei Instrument Technology Co., Ltd.

中華民國一一四年度年報
2025 ANNUAL REPORT

年報查詢網址：<http://mops.twse.com.tw>
本公司網址：<https://cmi-tw.com>

中華民國一一五年 四 月 二十二 日刊印

一、本公司發言人及代理發言人：

發言人：周庭卉

代理發言人：蔣承庭

職稱：財務長

職稱：資深特別助理

電話：(03)560-1788

電話：(03)560-1788

電子郵件信箱：IR@cmi-tw.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

名稱	地址	電話
總公司	新竹縣竹北市台元一街 8 號 4F-9、10、11、12、13、15、16	(03)560-1788
台元一廠	新竹縣竹北市台元一街 5 號 1F 之 3、5	(03)560-1788
台元二廠	新竹縣竹北市台元街 30 號 6F-5	

三、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：元大證券股份有限公司股務代理部

網址：<http://www.yuanta.com.tw>

地址：臺北市大安區敦化南路 2 段 67 號地下一樓

電話：886-2-2586-5859

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：陳明輝會計師、蔡美貞會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地址：新竹市東區科學工業園區展業一路 2 號 6 樓

電話：(03)578-0899

網址：<http://www.deloitte.com/tw>

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無

六、公司網址：<https://cmi-tw.com>

目 錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	5
參、募資情形	51
肆、營運概況	60
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	90
陸、特別記載事項	102

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生，大家好

回顧政美的發展，從以量測設備代理起家，到啟動自主研發，如今已走過近三十年的技術積累。早期公司聚焦於載板與 LED 相關檢測，隨著製程演進與市場需求轉向，政美逐步跨入半導體領域，歷經 12 年研發，政美整合軟硬體優勢，成功打造出系統平台「MOON」，成功整合 AI 缺陷分類 (ADC)、製程品管 (IQM) 與跨機台 Tool Matching 等模組，支援 2D/3D 高精度量測需求，協助客戶大幅縮短開發週期、提升良率。MOON 系統軟體平台不僅強化台灣設備自主供應鏈的深度，更建構未來營運成長之關鍵技術的護城河。

政美也已於 2025 年 7 月完成公開發行，並於 9 月正式登錄興櫃，為後續的全方位布局奠定資本基礎。

相關營運成果及計畫如下：

一、114 年度營運報告

(一) 營運計劃實施成果

回顧 114 年，在 AI、高效能運算與先進封裝需求帶動下，全球半導體的投資規模增加，也同步推進對於先進封裝設備的需求，在此持續推升設備需求之初步浪潮下，本公司 114 年度之合併營業額為 3.31 億元，營收較前一年度微幅成長 6%，因先進封裝產品之營收成長致營業毛利較前一年度增加 22%，為維持技術領先以進入高毛利市場，持續高強度的研發費用之投入，及為進入資本市場以增進籌資與提升營運能力，致營業費用增加，合併營業淨損為 175,981 仟元，合併稅後淨損為 176,307 仟元。

(二) 預算執行情形

本公司 114 年度未對外公開財務預測，故不適用。

(三) 財務收支及獲利能力分析

單位:新台幣仟元

年度			114 年度	113 年度	增(減)比例
項目					
財務收支	營業收入		331,421	313,650	6%
	營業毛利		153,524	125,719	22%
	營業淨利(損)		(175,981)	(145,495)	-21%
	稅後淨利(損)		(176,307)	(122,228)	-44%
獲利能力 分析	資產報酬率(%)		-17.06%	-13.84%	-23%
	權益報酬率(%)		-39.29%	-31.89%	-23%
	佔實收資本 比率(%)	營業利益	-36.77%	-36.78%	--
		稅前純益(損)	-36.85%	-30.90%	-19%
	純益率(%)		-53%	-39%	-37%
	每股盈餘(元)		-4.21	-3.28	-28%

(四) 研究發展狀況

114 年度主要研發成果如下：

1. TLIR 複合相機光路光學模組
2. TLI S2/S3 線型多倍率光學系統開發整合
3. 雙進出料口 700mm 尺寸 panel EFEM 設計

4. Tool Matching 機差補償與參數正規化演算法開發
5. 設備模組化設計、生產流程暨 MES 導入
6. Software Ecosystem
7. 「Panel-Level 大面積 RDL 2D+3D 檢測設備計畫」申請經濟部產業升級創新平台輔導計畫(主題式研發計畫)案，業已榮獲經濟部審核通過，計劃期間為 112~114 年，於 114 年已順利完成並結案。

二、115 年度營運計劃概要

(一) 經營方針及重要的產銷政策

1. 生產政策

- (1) 與客戶共同開發新應用及新製程機台，朝向產品高附加價值及多元化發展。
本公司目前產品線已可支援多項先進封裝及相關檢測與量測應用，於部分超高階或跨製程整合之應用及產品覆蓋之深度與廣度，將全面與國際領導廠商之完整產品布局對齊。本公司將持續投入研發資源，朝向更高階製程節點及前段製程相關之檢測與量測應用發展，以逐步擴充產品線完整性，並提升整體產品競爭力。
- (2) 本公司累積多年之研發能量，主要涵蓋光學、機構、電控、軟體、系統整合等關鍵技術，更透過自製核心軟體平台與模組化系統架構設計，保留未來升級與功能擴充之彈性。同時，系統介面設計以使用者操作便利性為考量，並內建多項輔助設定之軟體工具，協助使用者進行參數設定與操作調整，有助於降低使用者學習曲線，提升設備導入與實際應用效率，進而降低客戶整體導入與運行成本。再加上即時且彈性之售後服務，可有效滿足客戶的需求。本公司更將持續透過自主研發、提升光機電整合能力、深化軟體與 AI 演算法等技術優勢，維持產品在精度、速度與可靠度上的差異化，強化市場競爭門檻，確保公司產品在技術性能與價值主張上保持領先地位，以在地化服務之優勢及高度客製化彈性深耕半導體產業，具快速回應客戶製程需求之能力，提供高度客製化的檢測與量測解決方案。

2. 銷售政策

本公司銷售策略聚焦於 AI、HPC 與 HBM 所帶動之先進封裝需求成長，主力推進高精度檢測與量測設備，以擴大市占與市場能見度。自行研發之 Argus/ Buffalo 等系列已成功導入並通過國際一線封測大廠驗證，顯示產品具備實際製程應用之可靠性，可作為拓展其他客戶與提升銷售轉換效率之有利基礎，並透過與研發團隊緊密合作以快速回饋市場需求、持續優化產品性能與效率，維持競爭優勢並擴大銷售成果。

- (1) 整合既有的技術優勢，邁向高階產品市場發展，以現有的銷售管道為基礎並持續強化行銷，採直接銷售為主、代理為輔之通路策略，以兼顧技術服務深度與市場拓展彈性。透過直接銷售模式，得以在先進封裝與 μ LED 等高技術門檻市場中，維持與關鍵客戶之直接溝通與專案導入效率，強化客戶黏著度。
- (2) 深化既有客戶合作關係，透過長期合作、客製化開發與在地技術支援，加強與既有客戶之合作與互動，並積極開發新客戶，隨時掌握客戶產品開發的最新動態，配合進行相關製程設備的合作開發，加快產品之研發、產製速度，建立共贏的合作模式。此外，在先進封裝（如 RDL、CoWoS / CoPoS 等）之關鍵製程應用能力上，更聚焦差異化技術與應用深度的持續強化，以高技術門檻與差異化製程能力建立競爭壁壘。

，避免同業價格競爭。

- (3) 運用在地的服務據點及有效的代理商管理，提供即時的產品銷售及售後服務與支援，提昇客戶滿意度。在區域布局方面，東南亞、日本、韓國及美國等擴張型市場透過具備在地經驗之代理商加速拓展；中國市場則由子公司負責營運與通路管理，以強化在地服務與專案回應效率。

3. 產品競爭力

本公司為先進封裝高階檢測與量測設備供應商，聚焦 CoWoS、SoIC、CoPoS、HBM 等關鍵製程。受 AI 與 HPC 帶動，相關設備市場之規模可望於 2026 - 2028 年快速成長。本公司具備光學量測、檢測與系統整合核心技術，產品已成功切入高階先進封裝市場，並具備與國際設備商競爭能力；另於 MicroLED 檢測設備領域已累積技術與實務經驗，可隨 CPO (Co-Packaged Optics) 技術發展成為中長期潛在成長動能。對於 2026 年度及未來數年之營運表現將有相當程度的助益。

(二) 未來發展策略

隨著 AI 浪潮持續推升高階晶片需求，全球半導體產業進入新一輪長線投資週期，台灣從製造、封測到設備全面參與國際供應鏈重組，也間接成為全球半導體擴產的重要推手。

在台灣半導體產業版圖持續向海外擴張的引領下，也帶動封測與記憶體業者同步擴產，形成產業鏈外溢效應，讓設備業者之訂單能見度更加明朗。2026 年將是先進封裝產業的重要轉折年，除 CoWoS 產能將持續倍增外，SoIC、WMCM 等新技術也將百花齊放，帶動封測需求外溢，嘉惠 OSAT 廠（委外封測代工廠），同時擴大設備廠的滲透率，相關設備業者均可望受惠。

綜觀產業情勢及公司之優勢，半導體先進封裝高階市場之檢測及量測設備將會是未來數年的主要成長動能。

本公司向來以自主研發技術及自主品牌，致力成為世界一流品牌並創造政美獨特的價值為目標，專注創新研發，以成為全球領先的半導體量測及檢測設備供應商為使命。

- (1) 本公司將以高精度、高速度、高穩定性的光學檢測與量測技術為核心，持續投入先進製程所需關鍵量測及檢測設備之研發，涵蓋 2.5D/3D IC 封裝、扇出型面板級封裝及 MicroLED 晶片轉移與量測等領域，成為客戶進行製程升級的首選合作夥伴，並深化與全球一線晶圓、IC 封測大廠、面板及 MicroLED 廠的合作關係，成為關鍵製程升級的解決方案領導者。
- (2) 本公司將本著一貫穩健的經營步伐，在既有的基礎上繼續強化自有研發能力，逐步取代進口設備，打破國際大廠在高階檢測與量測設備的市場壟斷，藉由導入 AI 演算法、3D 量測與智慧工廠系統，協助客戶完成產線智慧升級與產能優化，建立台灣自主技術與國際接軌的關鍵橋梁，實現設備國產化的在地自主能力。
- (3) 本公司將持續建構平台型技術生態系，導入軟硬整合服務，未來將結合硬體設備、量測演算法、數據分析平台與即時監控系統，提供客製化 Turnkey 解決方案，提升產品附加價值與客戶黏著度，推進產品朝「平台型智慧檢量測系統」發展。打造以技術創新、品質至上、永續經營為核心的企業，攜手客戶與夥伴，共同迎接半導體產業未來的挑戰。

本公司將秉持審慎樂觀的態度應对外部經濟環境瞬息的變化，不斷優化工作及研發環境，定期引進各領域的專家進行培訓，加強內部專業人才培育及訓練，並強化技術專利之布局，致力於提升內部核心關鍵技術能力。再加上嚴謹的管理機制落實穩健的公司治理原則，積極邁

入資本市場使有助於發現企業價值，藉由資本市場多元化的籌資工具以優化資本結構，將持續拓展以提升競爭力及整體獲利能力，為全體股東、員工及客戶創造最大的價值。謹此，再次感謝各位股東一直以來持續對公司的支持與鼓勵。

董事長：蔡政道



總經理：蔡政道



會計主管：黃麗香



貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主資料

(一) 董事及監察人

1. 董事及監察人之姓名、經（學）歷、持有股份及性質

115年4月13日，單位：股；%

職 稱	姓 名	性 別 年 齡	國 籍 或 註 冊 地	選 任 日 期	初 次 選 任 日 期	任 期 (年)	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管、董 事 或 監 察 人			備 註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
董事長	蔡政道	男 (61-70)	中 華 民 國	114.08.27	84.02.28	3 年	1,415,518 (註 2)	2.95%	915,518 (註 2)	1.91%	-	-	-	-	交通大學高階主管管理研究所 政美應用(股)公司 董事長兼總經理 政美應用(股)公司 創辦人	本公司總經理 大鵬投資股份有限公司董事長 政應(上海)科技有限公司 法定代表人	-	-	-	(註 1)-
法人董事及其代表人	大鵬投資股份有限公司	-	中 華 民 國	114.08.27	110.08.09	3 年	3,152,190	6.58%	3,152,190	6.59%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	代表人： 汪業傑	男 (61-70)					-	-	-	-	-	-	-	-	國立清華大學材料科學與工程碩士 台灣積體電路製造(股)公司 營運組織人力資源業務夥伴處處長 台灣積體電路製造(股)公司	玖洋投資有限公司 董事	-	-	-	(註 3)

職 稱	姓 名	性 別 年 齡	國 籍 或 註 冊 地	選 任 日 期	初 次 選 任 日 期	任 期 (年)	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 、 董 事 或 監 察 人			備 註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
															智能工程中心 處長 台灣積體電路 製造(股)公司 三廠廠長					
董事	陳五福	男 (71-80)	中 華 民 國	114.08.27	110.08.09	3 年	300,000	0.63%	300,000	0.63%	-	-	-	-	加州柏克萊大學 電腦科學博士 台灣橡子園 顧 問有限公司 董 事長	台杉投資管理 顧問股份有限 公司審核委員 台灣橡子園 顧 問有限公司董 事長 安聯材料科技 股份有限公司董 事 永悅健康股份 有限公司董事 紫金堂股份有 限公司董事 創世投創股份 有限公司監察 人	-	-	-	-
獨立 董事	彭明秀	女 (61-70)	中 華 民 國	114.08.27	114.08.27	3 年	-	-	-	-	-	-	-	-	國 立 交 通 大 學 EMBA碩士 海驊投資有限公 司董事/執行長 虹光精密股份有 限公司獨立董事 盛美半導體設備 股份有限公司獨	海驊投資有限公 司董事/執行長 虹光精密股份有 限公司獨立董事 盛美半導體設備 股份有限公司獨 立董事 天擎積體電路股 份有限公司獨立	-	-	-	-

職 稱	姓 名	性 別 年 齡	國 籍 或 註 冊 地	選 任 日 期	初 次 選 任 日 期	任 期 (年)	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內之其他主或管、董事或監察人			備 註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
															立董事 天擎積體電路股份有限公司獨立董事	董事				
獨立 董事	楊 千	男 (71-80)	中 華 民 國	114.08.27	114.08.27	3 年	-	-	-	-	-	-	-	-	國立陽明交通大學管理學院兼任教授 朋億股份有限公司獨立董事 禾榮科技股份有限公司獨立董事 嘉彰股份有限公司董事 偉聯科技股份有限公司獨立董事	朋億股份有限公司獨立董事 禾榮科技股份有限公司獨立董事 嘉彰股份有限公司董事 偉聯科技股份有限公司獨立董事	-	-	-	-
獨立 董事	葉維焜	男 (61-70)	中 華 民 國	114.08.27	114.08.27	3 年	-	-	-	-	-	-	-	-	美國密西根州立大學電機工程碩士 立捷電子股份有限公司董事長 偉詮電子股份有限公司獨立董事 耕心文教股份有限公司董事 台灣芯福里情緒教育推廣協會常務理事 台灣積體電路股份有限公司部經理	立捷電子股份有限公司董事長 偉詮電子股份有限公司獨立董事 耕心文教股份有限公司董事 台灣芯福里情緒教育推廣協會常務理事	-	-	-	-

職 稱	姓 名	性 別 年 齡	國 籍 或 註 冊 地	選 任 日 期	初 次 選 任 日 期	任 期 (年)	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內其他主或監察人			備 註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
獨立 董事	莊柏年	男 (61-70)	中 華 民 國	114.08.27	114.08.27	3 年	-	-	-	-	-	-	-	-	國立彰化師範大學工業教育碩士/博士 工研院機械所/量測中心副主任 工業技術研究院特聘研究 和大工業股份有限公司獨立董事 台灣精銳科技股份有限公司獨立董事	工業技術研究院特聘研究 和大工業股份有限公司獨立董事 台灣精銳科技股份有限公司獨立董事	-	-	-	-

註：截至年報刊印日止，仍在任者。

註1：本公司董事長兼任總經理，係為提升經營效率與決策執行力。

註2：蔡政道總經理保留運用決定權信託股數 500,000 股交付元大銀行受託信託財產專戶。

註3：大鵬投資股份有限公司於 115/2/13 改派法人代表人汪業傑擔任董事。

2. 董事屬法人股東代表者，其法人股東之主要股東

115 年 4 月 22 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比率(%)
大鵬投資股份有限公司	蔡政道	92.34%
	蔡慧勳	7.66%

3. 董事屬法人股東代表者，其法人股東之主要股東屬法人者其主要股東：

本公司董事法人股東並無主要股東屬法人者。

4. 董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董 事 蔡政道		- 相關學經歷請詳(一)董事及監察人資料，具豐富之相關產業及企業經營管理經驗。 - 未有公司法第 30 條各款情事之一。	非獨立董事，故不適用。	無
法人董事大鵬投資股份有限公司 代表人汪業傑				無
董 事 陳五福				無
獨立董事 彭明秀			本公司獨立董事均非為本公司或其關係企業之受僱人、經理人、董事、監察人，或前述之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬，或由本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東，或由直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人，或與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人，或與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事、監察人或受僱人，或與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事、監察人、經理人或持股 5%以上股東，或為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事、監察人、經理人及其配偶，且未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。	3
獨立董事 楊 千				3
獨立董事 葉維焜				1
獨立董事 莊柏年				2

5. 董事會多元化及獨立性：

(1)董事會多元化：

本公司已訂定「公司治理實務守則」，明訂董事會成員應考量多元化，除兼任本公司經理人董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當的多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能與產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

目前董事會成員組成為 6 位男性及 1 位女性，董事分別具備執行業務所需之知識、技能、財金及管理 etc 豐富之產業相關經驗。

董事成員中具員工身份之董事占比為 14.3% (1 位)，女性董事占比為 14.3% (1 位)，獨立董事占比為 57.1% (4 位)。

多元化項目 董事姓名	性別	年齡	國籍	是否具員工身分	產業經歷				專業能力		
					經營管理	財務會計	產業經歷	專業知識	財務會計	領導決策能力	經營管理
董事長 蔡政道	男	61-70	中華民國	是	√		√	√		√	√
董事 汪業傑	男	61-70	中華民國	否	√		√	√		√	√
董事 陳五福	男	71-80	中華民國	否	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事 彭明秀	女	61-70	中華民國	否	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事 楊 千	男	71-80	中華民國	否	√		√	√		√	√
獨立董事 葉維焜	男	61-70	中華民國	否	√		√	√		√	√
獨立董事 莊柏年	男	61-70	中華民國	否	√		√	√		√	√

(2)董事會獨立性：

本公司董事會成員為七席董事，多已與本公司產業或經營業務相關之經驗為主要考量，整體而言已具備經營管理、財務與金融、資訊與科技、具備產業經驗和專業知識，並跨足多項產業領域且有互補能力。

董事會成員中，獨立董事共 4 位，均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條獨立性及第 4 條兼任限制，且所有董事與獨立董事間符合證券交易法第 26 條之 3 第 3 項規定，未有配偶及二親等以內親屬關係之情形，本公司董事會組成符合獨立性要求。

(二) 總經理、副總經理、協理及各部門及分支機構主管資料

115 年 4 月 13 日；單位：股；%

職 稱	姓 名	性 別	國 籍	就任日期	持有股份		配偶、未 成年子女 持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任其他公司 之職務	具配偶或二親等以 內關係之經理人			經理人 取得員 工認股 權憑證 情形	備 註
					股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職稱	姓 名	關 係		
總經理	蔡政道	男	中 華 民 國	84.05.01	915,518 (註 3)	1.91%	-	-	-	-	交通大學高階主管管理研究所 政美應用(股)公司 董事長兼總經理 政美應用(股)公司 創辦人	大鵬投資股份有限 公司董事長 政應(上海)科技有 限公司 法定代表人	-	-	-		(註 1)
財務長	周庭卉	女	中 華 民 國	114.12.01	4,000	0.01%	-	-	-	-	交通大學管理科學研究所 政美應用(股)公司 財務長 鏢創科技(股)公司 財會處長/管理處長 光磊科技(股)公司 稽核經理	-	-	-	-		(註 4)
技術長	黃朝瑜	男	中 華 民 國	93.02.09	609,000 (註 5)	1.27%	-	-	-	-	成功大學機械研究所 政美應用(股)公司 研發中心副總 政美應用(股)公司 研發處處長	政應(上海)科技有 限公司董事	-	-	-	(註 2)	-
資深 處長	蔣仁主	男	中 華 民 國	95.09.18	172,000 (註 6)	0.36%	-	-	-	-	清雲技術學院電機工程系 政美應用(股)公司 總經理室協理 政美應用(股)公司 產品中心經理	-	-	-	-		-
會計 主管	黃麗香	女	中 華 民 國	104.09.07	100,000 (註 7)	0.21%	-	-	-	-	中興大學財稅系 政美應用(股)公司 財會處資深處長 台灣茂矽(股)公司 財務處副處長 瀚宇彩晶(股)公司 會計處副處長	-	-	-	-		-

註：截至年報刊印日止，仍在任者。

註 1：董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施之相關資訊：

本公司董事長暨總經理主要係因本公司為簡化管理架構所致。本公司重大營運決策皆需經過董事會討論，且董事會有權選舉董事長、任免總經理，可適時發揮制衡作用；本公司為落實監督功能，使獨立董事共計四席，且未有過半數董事兼任員工之情事。

註 2：請參閱本年報「參、募資情形之五、員工認股權憑證辦理情形」。

註 3：蔡政道總經理保留運用決定權信託股數 500,000 股交付元大銀行受託信託財產專戶。

註 4：周庭卉財務長於 114/12/01 到職。

註 5：黃朝瑜技術長保留運用決定權信託股數 60,000 股交付元大銀行受託信託財產專戶。

註 6：蔣仁主資深處長保留運用決定權信託股數 45,000 股交付元大銀行受託信託財產專戶。

註 7：黃麗香會計主管保留運用決定權信託股數 30,000 股交付元大銀行受託信託財產專戶。

二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金

(一) 董事及獨立董事之酬金

114 年 12 月 31 日，單位：新臺幣千元；千股；%

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C 及 D 等四項 總額占稅後 純益之比例 (%)		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、 D、E、F 及 G 等七項總額及 占稅後純益之 比例(%)		領取 來自子公 司以外轉 投資業或 母公司酬 金
		報酬(A) (註 1)		退職退休 金(B)		董事酬勞 (C) (註 2)		業務執行 費用(D) (註 3)				薪資、獎金及 特支費等(E) (註 4)		退職退 休金(F)		員工酬勞(G)						
		本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	現 金 金 額	股 票 金 額	現 金 金 額	股 票 金 額	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	
董事長	蔡政道(註 5)	-	-	-	-	-	-	6	6	(0.0 0)	(0.00)	6,419	6,419		-	-	-	-	-	6,425 (3.64)	6,425 (3.64)	-
董事	大鵬投資股份有限公司 代表人: 汪業傑(註 6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	代表人: 蔡俊霖(註 6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	代表人: 陳壽康(註 6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,195	2,195	67	67	-	-	-	-	2,262 (1.28)	2,262 (1.28)	-
董事	陳彥睿(註 7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
董事	李志翔(註 7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
董事	陳五福	-	-	-	-	-	-	6	6	(0.0 0)	(0.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 (0.00)	6 (0.00)	-
獨立董事	彭明秀	240	240	-	-	-	-	6	6	(0.1 4)	(0.14)	-	-	-	-	-	-	-	-	246 (0.14)	246 (0.14)	-
獨立董事	楊 千	240	240	-	-	-	-	6	6	(0.1 4)	(0.14)	-	-	-	-	-	-	-	-	246 (0.14)	246 (0.14)	-
獨立董事	葉維焜	240	240	-	-	-	-	6	6	(0.1 4)	(0.14)	-	-	-	-	-	-	-	-	246 (0.14)	246 (0.14)	-
獨立董事	莊柏年	240	240	-	-	-	-	6	6	(0.1 4)	(0.14)	-	-	-	-	-	-	-	-	246 (0.14)	246 (0.14)	-

1. 請敘明獨立董事酬金之給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：請參閱本年報第17頁。
2. 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註1：係114年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等)。

註2：係114年度無董事會通過分派之董事酬勞金額。

註3：係114年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等)。

註4：係114年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等。

註5：兼任本公司之總經理。

註6：兼任本公司財務長暨資深副總經理。

註7：於114/8/27股東臨時會全面改選，解任。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	汪業傑、蔡俊霖、陳壽康(註2)、陳彥睿、李志翔、陳五福、彭明秀、楊 千、葉維焜、莊柏年、蔡政道(註1)	汪業傑、蔡俊霖、陳壽康(註2)、陳彥睿、李志翔、陳五福、彭明秀、楊 千、葉維焜、莊柏年、蔡政道(註1)	汪業傑、蔡俊霖、陳彥睿、李志翔、陳五福、彭明秀、楊 千、葉維焜、莊柏年、	汪業傑、蔡俊霖、陳彥睿、李志翔、陳五福、彭明秀、楊 千、葉維焜、莊柏年、
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	-	-	-	-
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	-	-	陳壽康(註2)	陳壽康(註2)
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	-	-	-	-
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	-	-	蔡政道(註1)	蔡政道(註1)
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	-	-	-	-
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	-	-	-	-
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	-	-	-	-
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	11 人	11 人	11 人	11 人

註1：兼任本公司之總經理。

註2：大鵬投資股份有限公司於114/8/27改派代表人，由陳壽康先生改派蔡俊霖先生、於115/2/13由蔡俊霖先生改派汪業傑先生。

(二) 監察人之酬金

114 年 12 月 31 日，單位：新臺幣千元；千股；%

職稱	姓名	監察人酬金						A、B 及 C 等三項總額 及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業 或母公司酬金
		報酬(A)		酬勞(B)		業務執行費用(C)				
		本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	
監察人	黃東村	-	-	-	-	-	-	-	-	-
監察人	謝宏琳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

註：本公司於 114/8/27 股東臨時會全面改選，選任獨立董事並成立審計委員會取代監察人。

酬金級距表

給付本公司各個監察人酬金級距	監察人姓名	
	前三項酬金總額(A+B+C)	
	本公司	財務報告內所有公司 D
低於 1,000,000 元	黃東村、謝宏琳	黃東村、謝宏琳
1,000,000 元（含）～2,000,000 元（不含）	-	-
2,000,000 元（含）～3,500,000 元（不含）	-	-
3,500,000 元（含）～5,000,000 元（不含）	-	-
5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）	-	-
10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）	-	-
15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）	-	-
30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含）	-	-
50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含）	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	共 2 人	共 2 人

(三) 最近年度給付總經理及副總經理等之酬金

114 年 12 月 31 日；單位：新臺幣千元；%

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	蔡政道	11,466	11,466	207	207	1,901	1,901	-	-	-	-	13,574 (7.70)	13,574 (7.70)	-
財務長暨資深副總經理	陳壽康 (註)													
技術長	黃朝瑜													

註：陳壽康先生於 114/11/30 卸任。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	-	-
1,000,000 元（含）～2,000,000 元（不含）	-	-
2,000,000 元（含）～3,500,000 元（不含）	陳壽康	陳壽康
3,500,000 元（含）～5,000,000 元（不含）	黃朝瑜	黃朝瑜
5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）	蔡政道	蔡政道
10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）	-	-
15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）	-	-
30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含）	-	-
50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含）	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	共 3 人	共 3 人

(四) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

本公司 114 年度無發放員工酬勞之情事。

(五) 分別比較說明本公司及合併報告所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或合併財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效與未來風險之關聯性

A. 本公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析

單位:千元；%

年度 項目	113 年度				114 年度			
	酬金總額		占稅後純益比率(%)		酬金總額		占稅後純益比率(%)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董事(註)	6,908	6,908	(5.62)	(5.62)	9,677	9,677	(5.49)	(5.49)
監察人	-	-	-	-	-	-	-	-
總經理及副總經理	14,761	14,761	(12.08)	(12.08)	13,574	13,574	(7.70)	(7.70)

註：係董事長兼任總經理領取之酬金

B. 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性

本公司章程已明定董監事酬勞發放標準；總經理酬金係依其職務薪資標準，考量其對營運的貢獻程度以及所承擔責任，同時參考同業薪資水準、公司營運績效及個人績效而酌給的合理報酬。本公司支付董監事、總經理之酬金，皆已併同考量公司未來的營運發展與經營風險，同時評估其與經營績效之正向關聯性，以謀永續經營與風險控管之平衡。

三、 公司治理運作情形：

(一) 董事會運作情形

本公司董事會最近年度及 115 年截至年報刊印日止，董事會共計開會 13 次，董事、監察人及獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數	委託出席 次數	實際出(列) 席率(%)	備註
董事長	蔡政道	13	0	100	114/8/27股東臨時會全面改選，連任。
法人董事	大鵬投資股份有限公司代表人： 陳壽康	6	0	62	114/8改派法人董事代表人 114年8月13日第七次董事會請假
法人董事	大鵬投資股份有限公司代表人： 蔡俊霖	1	3		114/4上任法人董事代表人115/3改派法人董事代表人
法人董事	大鵬投資股份有限公司代表人： 汪業傑	1	1		115/3上任法人董事代表人
董事	陳五福	12	1	92	114/8/27股東臨時會全面改選，連任。
董事	陳彥睿	7	0	100	114/8/27股東臨時會全面改選，解任。
董事	李志翔	6	1	86	
監察人	黃東村	7	0	100	114/8/27股東臨時會全面改選，選任獨立董事並成立審計委員會取代監察人。
監察人	謝宏琳	7	0	100	
獨立董事	彭明秀	6	0	100	114/8/27股東臨時會全面改選，新任。
獨立董事	楊 千	6	0	100	
獨立董事	葉維焜	5	1	83	
獨立董事	莊柏年	6	0	100	
其他應記載事項：					
一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：					
(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：					
本公司已設置審計委員會，故不適用證券交易法第 14 條之 3 規定。					
(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。					
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：					
董事會	姓名	議案內容	利益迴避原因	參與表決情形	

日期/屆次				
114/4/25 第四次	蔡政道 陳壽康	本公司 114 年度限制員工權利新股第一次發行之核定獲配員工名單及其被授與股數案。	蔡政道及陳壽康董事兼任本公司經理人	迴避並未參與討論及表決
114/8/27 第一屆 第一次	彭明秀 楊千 葉維焜 莊柏年	委任本公司第一屆審計委員會委員案	本案係委任獨立董事擔任審計委員會之委員	迴避並未參與討論及表決
114/8/27 第一屆 第一次	彭明秀 楊千 葉維焜 莊柏年	委任本公司第一屆薪資報酬委員會委員案	本案係委任獨立董事擔任薪資報酬委員會之委員	迴避並未參與討論及表決
114/09/14 第一屆 第二次	蔡政道	董事及經理人薪酬討論案	蔡政道董事兼任本公司經理人	迴避並未參與討論及表決
114/11/28 第一屆 第三次	蔡政道	審議本公司 114 年度經理人薪資報酬案	蔡政道董事兼任本公司經理人	迴避並未參與討論及表決
114/11/28 第一屆 第三次	蔡政道	審議本公司 114 年度經理人年終獎酬案	蔡政道董事兼任本公司經理人	迴避並未參與討論及表決
115/02/10 第一屆 第四次	蔡政道	審議本公司 114 年度經理人年終獎金報酬案	蔡政道董事兼任本公司經理人	迴避並未參與討論及表決
115/03/20 第一屆 第五次	蔡政道	政美應用(股)公司經理人名單案	蔡政道董事兼任本公司經理人	迴避並未參與討論及表決
115/03/20 第一屆 第五次	蔡政道 陳五福 汪業傑 楊千 彭明秀	審議政美應用(股)公司 115 年度董事、獨立董事車馬費暨董事報酬案	因本案涉及所有董事，因此各董事逐一進行討論，也請被討論的董事進行利益迴避	本案相關董事已逐一進行利益迴避並未參與討論及表決

	葉維焜 莊柏年			
115/04/20 第一屆 第六次	蔡政道	改派政應(上海)科技有 限公司子公司第一屆董 事追認案	蔡政道董事兼任本 公司子公司之法人 董事代表人	迴避並未參與討論及 表決
115/04/20 第一屆 第六次	蔡政道	政美應用(股)公司 2026 年經理人調薪案	蔡政道董事兼任本 公司經理人	迴避並未參與討論及 表決
115/04/20 第一屆 第六次	蔡政道	解除新任法人董事代表 人汪業傑先生，之競業 行為之限制案	汪業傑董事此次委 任蔡政道董事出席	迴避並未參與討論及 表決

三、本公司董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：不適用。唯本公司已於 115/2/10 經董事會通過「董事會績效評估辦法」，將於 115 年度進行董事會自我(或同儕)評鑑之評估，持續強化公司治理及董事會運作。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

- (一)本公司於 114 年 8 月 27 日股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，並成立審計委員會，由全體獨立董事擔任委員，行使證券交易法、公司法及其他法令規定之職權。
- (二)本公司於 114 年 8 月 27 日成立薪資報酬委員會，委任獨立董事擔任委員，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，加強董事會執行其職責。
- (三)本公司董事會負責指導公司策略、監督管理階層、公司治理制度之各項作業與安排、依照法令及公司章程規定或股東會決議行使職權並對公司及股東負責。
- (四)本公司於 115 年 3 月 20 日董事會通過設置公司治理主管，協助董事執行業務所需之相關資訊及其他必要之協助。
- (五)本公司七席董事中，獨立董事共計四席，強化董事會監督。

(二) 審計委員會運作情形：

本公司最近年度及 115 年度截至年報刊印日止，審計委員會開會共 4 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數	委託出席 次數	實際出(列) 席率(%)	備註
獨立董事	彭明秀	4	0	100	114/8/27股東臨時會全面改選，選任獨立董事並成立
獨立董事	楊 千	4	0	100	

獨立董事	葉維焜	3	1	75	審計委員會取代監察人。 由彭明秀擔任召集人
獨立董事	莊柏年	4	0	100	

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(一)證券交易法第14條之5所列事項：

審計委員會日期/期別	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
114/09/14 第一屆 第一次	1.本公司稽核主管任命案	全體出席委員 無異議照案通過	照案通過
114/11/28 第一屆 第二次	1. 本公司 115 年度簽證會計師委任及報酬案 2. 本公司擬修訂「內部稽核實施細則」案 3. 本公司擬訂定「內部控制制度自行評估作業程序」案 4. 本公司擬修訂「內部控制制度」各類循環案 5. 本公司 115 年度稽核計劃案 6. 本公司擬訂定「內部重大資訊處理作業程序」案 7. 本公司擬修訂「防範內線交易管理作業程序」案 8. 本公司財務長聘任案及財務主管暨發言人任命案	全體出席委員 無異議照案通過	照案通過
115/03/20 第一屆 第三次	1. 本公司 114 年度營業報告書及財務報表(含個體及合併報表)案 2. 本公司 114 年度虧損撥補案	會計主管代理人報告：因應公司後續上市送件作業需求，為審慎檢視相關財務報表科目之分類、認列及揭露方式，並確認符合中華民國相關法令、主管機關申報規定及公司整體送件時程安排，擬就本案	經主席徵詢全體出席委員，決議本案暫不討論暫不決議，待 4 月份召開之下次董事會續行審議。

		相關內容再行檢視與確認後，提預計於4月份召開之下次董事會續行審議。 財務長報告：公司將與會計師再確認後於4月份再次提案請各位委員審議，建議本案暫不討論暫不決議。	
	3. 本公司稽核主管任命案 4. 114 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案	全體出席委員 無異議照案通過	照案通過
115/04/20 第一屆 第四次	1. 114 年度營業報告書及財務報表(含個體及合併報表)案 2. 本公司 114 年度虧損撥補案 3. 擬制定及修訂內部控制制度相關循環及其他管理辦法 4. 擬發行限制員工權利新股案 5. 擬變更 115 年度稽核計畫案	全體出席委員 無異議照案通過	照案通過

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過而全體董三分之二以上同意議決事項：無此情形。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

(一)本公司審計委員會係由全體獨立董事組成，本公司內部稽核主管透過定期提交稽核報告予審計委員會委員，報告公司內部稽核結果，且審計委員不定期與稽核人員溝通，瞭解公司營運狀況，雙方溝通順暢。

(二)本公司簽證會計師列席審計委員會，並由簽證會計師單獨向獨立董事進行報告及溝通，內容包含季及年度報告財務報表風險評估、關鍵查核事項之溝通及IFRSs公報修訂或其他法令發佈對公司之影響，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告，雙方溝通順暢。

(三) 公司治理運作情形及其上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」，訂定「公司治理實務守則」並揭露於公司網站。	無重大差異
二、公司股權結構及股東權益				
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		(一) 本公司除於公司章程及內部規則明定股東權益保障事項外，另設有專責單位專責處理有關公司對投資人關係等事宜，以妥善處理股東建議、疑義及糾紛事項。同時，本公司設有發言人、代理發言人及委託專業股務代理機構，作為處理股東建議、疑義或糾紛等相關問題。	無重大差異
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		(二) 本公司透過投資人關係維繫及內部人申報制度了解公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之變化。	無重大差異
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		(三) 本公司訂有「子公司監理作業辦法」，藉以落實對子公司之風險控管及防火牆機制，且已制定「關係人交易之管理」，並已依照該辦法之規定，建立並定期更新關係企業名單。與關係企業之交易亦依該辦法之規定，依循一般商業常規。	無重大差異
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		(四) 本公司已訂定「防範內線交易管理作業程序」規範公司內部重大資訊保密作業及禁止買賣程序，內部人於年度財務報告公告前 30 日及每季財務報告公告前 15 日不得交易其持有股份，並揭露於公司網站。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？ (二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？ (三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		(一) 本公司於 114 年 7 月 14 日第六次董事會通過訂定「公司治理實務守則」，要求董事會成員組成注重多元化要素，設定管理目標，並普遍具備執行職務所必備之知識、技能及素養，並落實執行之。董事多元化政策、具體管理目標及落實執行已揭露於本年報董事多元化情形。 (二) 本公司已設置薪資報酬委員會及審計委員會，將規劃設置「永續發展委員會」，由董事會成員擔任委員，未來依公司需求設置其他各類功能性委員會。 (三) 為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司已於 115 年 2 月 10 日經董事會通過「董事會績效評估辦法」，將於 115 年度進行董事會自我(或同儕)評鑑之評估，持續強化公司治理及董事會運作。 (四) 本公司每年定期評估簽證會計師適任性及獨立性，由會計師提供獨立性聲明書及審計品質指標進行評估。本公司依公司治理實務守則規定，於 114 年 11 月 28 日經審計委員會及董事會審議通過簽證會計師適任性及獨立性。	無重大差異 無重大差異 無重大差異 無重大差異
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓		本公司已於 115 年 3 月 20 日董事會通過任命財務長周庭卉女士兼任公司治理主管一職，主要為規劃及督導公司治理相關事務之辦法及提供董事支援，職權範圍包含： • 依法辦理董事會、功能性委員會及股東會之會議相關	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
			事宜。 • 製作董事會、功能性委員會及股東會議事錄。 • 協助董事就任及持續進修。 • 提供董事執行業務所需之資料。 • 協助董事遵循法令。 • 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規定之檢視結果。 • 辦理董事異動相關事宜。 • 其他依公司章程所訂定之事項。	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		(一)本公司設有發言人及代理發言人作為公司對外發表意見之管道，並遵循內部控制制度辦理相關回應事宜。 (二)本公司於公司網站已建置公司利害關係人專區，載明利害關係人窗口資訊。	無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司已委任元大證券股份有限公司股務代理部辦理股東會相關事務。	無重大差異
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓		(一) 本公司已於公司網站揭露公司財務業務相關資訊及公司治理資訊之情形。 公司網站： https://cmi-tw.com/	無重大差異
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	✓		(二) 本公司業已於公司網站揭露左列之資訊揭露專區。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？		✓	(三) 本公司於 114 年 9 月 30 日興櫃登錄，114 年度財報及各月份營運情形，皆依法令規定公告並申報完成。	無重大差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	✓		(一) 員工權益：本公司依照勞基法及人事規章之規定，保障員工合法權益，並定期召開勞資會議，協調勞資關係。 (二) 僱員關懷：本公司秉持友善職場環境之理念徵才及留才，塑造良好之工作環境，除設有職工福利委員會，依法提撥職工福利金外，另依法提撥員工退休金，加保員工團體意外險並安排員工健康檢查，以謀求員工最大福利。 (三) 投資者關係：本公司已設置企業網站及發言人制度，已建立順暢之溝通管道，確保投資人權益。 (四) 供應商關係：本公司與供應商均有良好的供應鏈關係，達到整體生產成本最佳化。 (五) 利害關係人之權利：本公司與員工、往來客戶及供應商等均保持良好之溝通管道，並尊重且維護其合法之權益。利害關係人得隨時提供意見與公司溝通，公司均非常重視各項意見，以作為未來各項工作之參考依據。 (六) 董事及監察人進修之情形：本公司已設置審計委員會取代監察人職能。本公司董事均具專業背景，且皆已依法令規定參加進修課程，並取得證明文件。 (七) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：業依法訂定內部控制制度、內部稽核程序及各項內部規章辦法，並依辦法執行。 (八) 客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持穩定良好	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
			關係，以創造公司利潤。 (九) 公司為董事購買責任保險，每年評估投保額度及向董事會報告，投保情形請參閱公開資訊觀測站「董事投保責任險情形」。	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施： 本公司於 114 年 9 月 30 日興櫃登錄，非屬受評公司，故不適用。				

(四) 薪資報酬委員會之組成及運作情形

1. 薪資報酬委員會成員資料

身分別	姓名 條件	專業資格與經驗	符合獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事	彭明秀	請參閱本年報參、公司治理報告之董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露。	薪資報酬委員會委員為本公司四位獨立董事，均非為本公司或其關係企業之受僱人、經理人、董事、監察人，或前述之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬，或由本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東，或由直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人，或與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人，或與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事、監察人或受僱人，或與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事、監察人、經理人或持股 5%以上股東，或為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事、監察人、經理人及其配偶，且未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。	3
獨立董事 (召集人)	楊 千			3
獨立董事	葉維焜			1
獨立董事	莊柏年			2

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計4人。

(2)本屆委員任期：114年8月27日至117年8月26日，最近年度及截至年報刊印日止，薪資報酬委員會開會5次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出 席次數	實際出席率 (%)(B/A)	備註
獨立董事	彭明秀	5	0	100	114/8/27股東臨時會全面改選，選任獨立董事並成立薪資報酬委員會，由楊千擔任召集人。
獨立董事	楊 千	5	0	100	
獨立董事	葉維焜	4	1	80	
獨立董事	莊柏年	5	0	100	

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。

二、薪資報酬委員會之決議事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形

(四-1)提名委員會成員資料及運作情形資訊：

本公司尚未設立提名委員會。

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因						
	是	否	摘要說明							
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會督導情形？		✓	遵循本公司 ESG 政策的願景與使命，未來會設置「永續發展委員會」，以董事會為永續發展相關議題之最高決策單位，由董事長擔任主席，與多位不同領域的高階主管共同檢視公司的核心營運能力，訂定中長期的永續發展計畫。定期召開會議，指引及強化本公司在全球環境、社會及治理策略上的發展，內容包含(1)現行政策規範與組織；(2)永續發展推動情形；(3)重大永續議題之管理方針、目標及未來規劃，由董事會督導並檢討落實情形。由董事長指派高階經理人擔(兼)任永續長，負責評估全公司之永續議題、協調及促動公司目標之擬訂以及推動永續發展行動計畫之執行，並向委員會報告。	未來將依公司營運及相關法令規定辦理。						
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓		本公司永續發展風險評估邊界以本公司為主，本公司依據重大性原則定期評估與公司營運相關之環境、社會、公司治理相關重大性議題之風險評估標準、過程、結果及風險管理政策或策略，說明如下： <table><tr><th>重大議題</th><th>風險評估項目</th><th>說明</th></tr><tr><td>環境</td><td>環境衝擊及管理</td><td>1.本公司經由執行製程安全管理與制度化的管理循環，有效降低污染的排放與對環境所造成的衝擊。 2.本公司為求產品符合環保規定，本公司已取得ISO 14001環境管理驗證，後續並定期取得認證。 3. 依據「ISO 14064-1」盤查溫室氣體排放及驗證，檢視公司營運排放溫室氣體的情況與可能面臨的衝擊。根據碳盤查結果，持</td></tr></table>	重大議題	風險評估項目	說明	環境	環境衝擊及管理	1.本公司經由執行製程安全管理與制度化的管理循環，有效降低污染的排放與對環境所造成的衝擊。 2.本公司為求產品符合環保規定，本公司已取得ISO 14001環境管理驗證，後續並定期取得認證。 3. 依據「ISO 14064-1」盤查溫室氣體排放及驗證，檢視公司營運排放溫室氣體的情況與可能面臨的衝擊。根據碳盤查結果，持	無重大差異。
重大議題	風險評估項目	說明								
環境	環境衝擊及管理	1.本公司經由執行製程安全管理與制度化的管理循環，有效降低污染的排放與對環境所造成的衝擊。 2.本公司為求產品符合環保規定，本公司已取得ISO 14001環境管理驗證，後續並定期取得認證。 3. 依據「ISO 14064-1」盤查溫室氣體排放及驗證，檢視公司營運排放溫室氣體的情況與可能面臨的衝擊。根據碳盤查結果，持								

推動項目	執行情形				與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	
	是	否	摘要說明			
					續執行減碳措施，有效降低範疇一排放風險及因輸入電力、熱或蒸氣而造成的範疇二間接之溫室氣體排放。4. 年度規劃內部稽核計畫，針對合併公司須遵循各相關環境法規之合規情形，並稽查各作業流程已符合規定。	
			社會	職業安全	1.所有廠區皆完成ISO45001職業健康安全管理系統之驗證。 2.每年定期舉行消防與緊急應變疏散演練和危害鑑別風險評估和工安教育訓練，培養員工緊急應變和自我安全管理能力，免於員工接近可能造成傷害或疾病的情況。	
			公司治理	社會經濟與法令遵循	1.透過建立治理組織及落實內控制機制，確保本公司所有人員及作業確實遵守相法令規範。 2.本公司研發之產品申請專利保護公司權益。	
				強化董事職能	1.為董事規劃相關進修議題，提供董事最新法規、制度發展與政策。 2.為董事投保董事責任險，保障其受到訴訟或求償之情形。	
				利害關係人溝通	1.為避免利害關係人與本公司立場不同，造	

推動項目	執行情形					與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明			
					成誤解，引起經營或訴訟風險，本公司從公發開始每月分析利害關係人與其關心之議題。 2.建立各種溝通管道，積極溝通並減少對立。設投資人信箱，由發言人或投資人關係部門處理並回應。	
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		(一)本公司及子公司，除了符合法令及相關規範的規定外，皆依循 ISO14001 建立環境管理系統及持續通過第三方驗證，並依據 ISO14001 規範每年進行系統驗證。設立年度目標，以有效降低污染排放並適時檢討環境管理制度。			無重大差異。
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		(二)本公司積極推動各項能源減量措施，選用高能源效率及節能設計之設備，降低企業及產品能源消耗，並擴大再生能源之使用，使能源使用效率最佳化。 舉例： 1.改善辦公室照明，更換成省電照明設備，搭配電力使用調整，以減少能源消耗。 2.推動電子簽核系統及推廣電子郵件方式，減少大量用紙，同時宣導使用資源回收及節能減碳政策。 3.生產所使用的空壓設備為變頻式的，以減少能源消耗。			無重大差異。
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	✓		(三)本公司排碳相對少，不致加劇氣候變遷，而氣候變遷也不致對公司本身研發之現況及未來產生重大影響，故潛在風險小。在氣候變遷減緩面向，依綠色營運、能源管理、碳資訊揭露等項目發展；在氣候變遷調適面向，本公司已實施強化基礎措施、建構永續營運能力。本公司氣候變遷風險與機			無重大差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																
	是	否	摘要說明																	
			會分析之詳細說明，未來會揭露於本公司永續報告書。																	
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？		✓	(四)現行對能源/資源使用、用水量、廢棄物控管的方式如下： (1)能源/資源使用：公司型態為半導體設備組裝與測試，製程中並無產生經中央主管機關公告等相關有害空氣/廢水/土壤，在能源/資源的策略是預計推動生產製程節能專案，推動循環經濟，設計可重複使用或再製產品。 (2)用水量：僅一般民生用水並無製程用水。 (3)廢棄物：產品生產過程所衍生之一般生活廢棄物由清潔人員整理/分類清運到集中地，由房東定期統一委託合格廠商清理及進行後續焚化或是物化處理。有害廢棄物部分則是有配合之合格廠商依需要來廠進行清運，使本廠產生之廢棄物達到無害化標準。 (4)公司將依循相關法規規範要求執行溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策，同時追蹤減量目標、推動措施及達成情形等。 本公司已完成 114 年度範疇一及範疇二盤查。 <table><tr><th colspan="2">年度</th><th colspan="2">114 年度</th></tr><tr><th colspan="2">項目(單位)</th><th>排 放 量 (噸 CO2e)</th><th>密集度 (噸 CO2e/營業額新臺幣百萬元)</th></tr><tr><td rowspan="3">本公司</td><td>範疇一(直接排放)</td><td>9.5206</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>範疇二(間接排放)</td><td>588.8585</td></tr><tr><td>小計</td><td>598.3791</td></tr></table>	年度		114 年度		項目(單位)		排 放 量 (噸 CO2e)	密集度 (噸 CO2e/營業額新臺幣百萬元)	本公司	範疇一(直接排放)	9.5206		範疇二(間接排放)	588.8585	小計	598.3791	已完成 114 年度範疇一及範疇二盤查。
年度		114 年度																		
項目(單位)		排 放 量 (噸 CO2e)	密集度 (噸 CO2e/營業額新臺幣百萬元)																	
本公司	範疇一(直接排放)	9.5206																		
	範疇二(間接排放)	588.8585																		
	小計	598.3791																		

推動項目	執行情形						與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	
	是	否	摘要說明					
			合併財務報告所有子公司	範疇一(直接排放)	3.6450			
				範疇二(間接排放)	49.9859			
				小計	53.6309			
				總計			652.010	
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓		(一)本公司認同並自願遵循「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」、「聯合國企業與人權指導原則」、「聯合國國際勞動組織」等國際公認之人權標準，本公司在「工作規則」及「性侵害暨性騷擾防治措施及申訴、調查、處理辦法」，其中明訂工作場所性騷擾申訴方式及管道，確保兩性平權，在工作場所不受騷擾，訂有人權政策，列入新人訓練宣導課程，確保同仁了解自身權益及相關申訴管道。本公司實際的人權保障政策如下： 1. 提供安全與健康且零騷擾的工作環境 2. 杜絕不法歧視且確保工作機會均等 3. 禁用童工 4. 禁止強迫勞動 5. 營造樂於溝通的環境，並建立開放型管理模式 6. 支持並協助員工維持身心健康及工作生活平衡 7. 定期檢視及評估相關制度及作為					無重大差異。
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及	✓		(二)本公司之員工福利措施訂定及實施摘要說明如下： 1.員工薪酬					無重大差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
其他福利等)，並將經營績效獲成果適當反映於員工薪酬？			公司之薪酬秉持外部與內部平衡之原則，依循內部規範訂定合理之薪資。年節獎金制度，於考量公司之年度營運，並參酌員工之年資與年度績效情形後，分配予全體同仁，以激勵所有同仁共同為本公司目標努力。 <u>2.員工福利措施</u> 公司設立職工福利委員會，委員會規劃並提供優質的各項福利，例如:生日禮券、勞動節禮券。 <u>3.職場多元化與平等</u> 公司職員男女比例相當，且實踐不同性別擁有同工同酬的獎酬條件及平等晉升機會。 <u>4.經營績效反映於員工薪酬</u> 公司每年依據市場薪資水準、經濟趨勢及個人績效調薪，以維持整體薪酬競爭力；另針對績效優秀之同仁，頒發績效獎金。	
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		(三)本公司依據管理系統與法規要求，對每位新進員工實施新人職業安全衛生教育訓練，並定期對所有員工實施複訓、緊急應變教育訓練、相關規定宣導，加深同仁安全觀念，以上也列入每年度教育訓練規劃中持續執行。 本公司以災害預防及災害防止為核心理念，使用適當之管理工具與成熟的技術及可運用之資源，對於廠區內作業職安衛問題，提出有效對策，持續精進推動職業安全文化，加強作業人員之防護管理，並投入資源強化職業傷病預防，以創造零災害環境。 本公司每季召開職業安全衛生委員會議檢討缺失。	無重大差異。
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		(四)人才是本公司持續創新、維持產業地位的關鍵要素。本公司期許員工具有創新思維與行動力，建立優良的培訓機制，由內部講師定期開課，提供開放多元的學習	無重大差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			機會，透過訓練發展，為人才加值，且陸續將基礎能力課程轉為線上課程留存，傳承公司知識經驗。 本公司提供多元教育訓練，加強員工的職場專業能力，提供完整教育訓練，也鼓勵同仁參與企業外訓，自入職起，公司投入充足資源給予不同職務與職級同仁，各階段採取不同訓練計畫，進行系統化學習發展。 本公司教育訓練包含新進人員教育訓練、專業課程及主管管理課程。對外聘請專案的講師，亦積極培養內部講師，進行公司關鍵技術的傳承。依照不同領域的人才，培養專業跨領域研發、生產、製造、品質及管理的能力，以因應未來智能化浪潮與跨領域專才的整合人才庫。	
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓		(五)本公司掌握和管控產品的價值鏈，原物料與物流皆設置管理機制 並且持續追蹤產品安全訊息，以落實產品安全之承諾。 本公司設有客戶資料保護管理制度與政策，管理及保護客戶隱私。透過內部稽核、外部驗證及教育訓練，為客戶的機密資料嚴密把關。 針對客戶服務有專屬的產品經理(Product managers)，主動查核確認服務客戶政策之執行情形 接受客戶申訴並協助業務同仁處理客戶案件，做好維護客戶權益工作。	無重大差異。
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		(六) 本公司制定「供應商行為準則」，要求供應商於勞工、健康與安全、環境、商業道德及管理體系等方面之商業行為確實符合本準則，並完全遵守經營所在國家/地區的法律和法規。同時，本公司會定期進行查核，查核結果亦為公司決策的重要因素之一。	無重大差異。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務性資		✓	本公司雖尚未編制永續報告書，惟已將其納入年度工作目標，並著手規劃與籌備相關撰寫作業，以期後續能更系統性地揭露本公司於永續發展之作為與成果。	本公司未來將確實編制永續

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
訊之報告？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？				報告書，揭露企業永續發展相關資訊。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司已訂定公司永續發展實務守則，持續依該守則規定辦理，與「上市上櫃公司永續發展實務守則」無重大差異。				
於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 本公司網站已規劃建置永續發展專區，未來陸續將永續發展執行情形揭露於該專區，網址： https://www.cmi-tw.com 。				

(五-1) 符合一定條件之公司應揭露氣候相關資訊

本公司實收資本額未達新台幣五十億元，故暫不適用，預計 2026 年前完成個體公司溫室氣體範疇之盤查，於 2028 年前完成個體公司溫室氣體之查證。

(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		(一) 本公司已依據「上市上櫃公司誠信經營守則」，經董事會通過訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」。董事會與管理階層充分了解並積極落實相關作業規範，在內部管理及外部商業活動中確實執行。	無重大差異
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	✓		(二) 本公司遵循誠信經營原則，嚴禁行賄及收賄，並明訂不得提供非法獻金，另不定期向員工宣導企業倫理或有關公司治理之教育訓練。	無重大差異
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓		(三) 同上所述。	無重大差異
二、落實誠信經營				
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	✓		(一) 本公司商業交易對象均通過本公司「供應商管理程序」之審核，對於已合作之供應商/外包商，亦進行定期稽核與評核，並於合約中訂定相關商業誠信條款。	無重大差異
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期（至少一年一次）向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓		(二) 本公司已設立治理主管，將執行等相關作業，並定期向董事會報告其執行情形。	無重大差異

(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		(三) 對於業務往來上有利害關係者，事前告知主管及迴避，避免產生利益衝突；而董事對於其所自身及其代表人有利害關係，致有損公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決。	無重大差異
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	✓		(四) 本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員依稽核計畫查核前項制度遵行情形，並定期向董事會報告。	無重大差異
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		(五) 對員工舉辦教育訓練與宣導，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反誠信行為之後果。並設有員工申訴管道，保障員工與公司間的溝通，建立和諧勞動關係，凝聚共識。	無重大差異
三、公司檢舉制度之運作情形			本公司業經董事會通過訂定「誠信經營守則」，規定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及指派適當之受理專責人員。	無重大差異
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓			
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓		本公司業經董事會通過訂定「檢舉制度實施辦法」，規定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制。	
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		本公司業經董事會通過訂定「誠信經營守則」及「檢舉制度實施辦法」，規定公司應採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置。	
四、加強資訊揭露				
公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		本公司已制訂各項誠信經營守則制度，並將揭露於公司網站，以提供社會大眾隨時檢視。	無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所				

定守則之差異情形：本公司已訂定誠信經營守則，明確規範公司人員應遵守事項，另檢舉與懲處亦已明定於相關辦法中，與「上市上櫃公司誠信經營守則」並無重大差異。

六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）：

1. 本公司遵守證券交易法、公司法、商業會計法、上市上櫃相關規章或其商業行為有關法令，作為落實誠信經營的基石。環境以及品質政策，亦採行高標準遵循。
2. 本公司訂有「董事會議事規範」，訂有董事利益迴避制度，董事對於會議事項，與自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。
3. 本公司訂有「防範內線交易之管理辦法」，明訂內線交易適用對象於實際知悉重大消息，在該消息未公開或公開後十八小時內，不得自行或以他人名義買入或賣出本公司上市股票或其他具股權性質之有價證券或非股權性質之公司債。
4. 本公司訂有「內部重大訊息處理作業程序」，建立良好之內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當洩漏，並確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性。規範本公司董事、獨立董事、經理人及受僱人不得洩漏所知悉之內部重大資訊予他人，亦不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊，對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩漏。

(七) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：

1. 公司為董事購買責任保險。

投保對象	保險公司	投保金額	投保起迄期間
全體董事	新加坡商美國國際產 物保險股份有限公司 台灣分公司	美金壹佰萬元	114 年 9 月 4 日 ~ 115 年 9 月 4 日

(八) 內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1. 內部控制聲明書

政美應用股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：115 年 3 月 20 日

本公司民國 114 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國114年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國115年3月20日董事會通過，出席董事7人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

政美應用股份有限公司

董事長： 蔡政道



總經理： 蔡政道



2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：

請參閱本年報附件一、內部控制制度審查確信報告

(九) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1. 114 年股東會重要決議事項及執行情形

會議日期	重要決議事項	執行情形
114 年 4 月 25 日	更正 110 年度盈餘分配案	經股東會決議照案承認
	113 年度營業報告書及財務報表(含個體及合併報表)案	經股東會決議照案承認
	113 年度虧損撥補案	經股東會決議照案承認
	修訂「股東會議事規則」案	經股東會決議照案通過
	修訂「董事及監察人選舉辦法」案	經股東會決議照案通過
	修訂「公司章程」案	經股東會決議照案通過
	修訂「取得或處分資產處理程序」案	經股東會決議照案通過
	修訂「資金貸與他人作業程序」案	經股東會決議照案通過
	本公司擬發行 114 年度限制員工權利新股案	經股東會決議照案通過

2. 114 年股東臨時會重要決議事項及執行情形

會議日期	重要決議事項	執行情形
114 年 8 月 27 日	修訂「股東會議事規則」案	經股東會決議照案通過
	修訂「董事選舉辦法」案	經股東會決議照案通過
	修訂「公司章程」案	經股東會決議照案通過
	修訂「取得或處分資產處理程序」案	經股東會決議照案通過
	修訂「資金貸與他人作業程序」案	經股東會決議照案通過
	修訂「背書保證作業程序」案	經股東會決議照案通過
	本公司擬申請股票上市(櫃)案	經股東會決議照案通過
	辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理，並請原股東全數放棄優先認股權利案	經股東會決議照案通過

	本公司全面改選董事(含獨立董事)案	依股東會選舉結果公告
	通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案	依決議解除新任董事之競業禁止

3.董事會重要決議事項

會議日期	重要決議事項
114 年 01 月 22 日	1. 擬修訂子公司政應(上海)科技有限公司「公司章程」案 2. 擬指派子公司政應(上海)科技有限公司董事及監事案
114 年 03 月 17 日	1. 本公司 113 年度營業報告書及財務報表(含個體及合併報表)案 2. 本公司 113 年度虧損撥補案 3. 本公司擬修訂「公司章程」案 4. 本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」案 5. 本公司擬修訂「資金貸與他人作業程序」案 6. 本公司擬修訂「股東會議事規則」案 7. 本公司擬修訂「董事會議事規則」案 8. 本公司擬修訂「董事及監察人選舉辦法」案 9. 本公司擬制訂「會計制度」案 10. 本公司 114 年度簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任報酬案 11. 本公司擬辦理股票全面無實體發行案 12. 本公司擬發行 114 年度限制員工權利新股案 13. 本公司向金融機構申請營運資金融資額度案 14. 本公司 114 年度股東常會召開事宜案 15. 受理 114 年度股東常會股東提案之相關事宜案
114 年 03 月 26 日	1. 更新本公司擬發行 114 年度限制員工權利新股案
114 年 04 月 25 日	1. 更新本公司 114 年度限制員工權利新股發行辦法案 2. 本公司 114 年度限制員工權利新股第一次發行之核定獲配員工名單及其被授與股數案
114 年 06 月 20 日	1. 因營運需求，本公司擬購置台元科技園區辦公室案 2. 本公司向金融機構申請營運資金融資額度案 3. 本公司擬申請 3~7 年中長期授信案 4. 本公司 113 年度「內部控制制度聲明書」案 5. 本公司擬修訂「內部控制制度」部分條文案 6. 本公司擬辦理公開發行申請案 7. 本公司擬辦理 114 年現金增資發行普通股案 8. 本公司健全營運計劃書案 9. 本公司擬參與子公司政應(上海)科技有限公司現金增資案 10. 本公司擬改派子公司政應(上海)科技有限公司法定代表人案

	11. 本公司擬更換股務代理機構案 12. 擬解除董事及其代表人競業禁止限制案
114 年 07 月 14 日	1. 本公司擬修訂「公司章程」案 2. 本公司擬全面改選董事(含獨立董事)案 3. 本公司擬議提名董事及獨立董事候選人名單暨資格審查案 4. 本公司設置審計委員會暨訂定「審計委員會組織規程」案 5. 本公司受理董事(含獨立董事 4 席)候選人提名之相關事宜案 6. 擬解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案 7. 本公司擬申請股票登錄興櫃案 8. 本公司擬申請股票上市(櫃)案 9. 辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理，並請原股東全數放棄優先認股權利案 10. 本公司設置薪資報酬委員會暨訂定本公司「薪酬委員會組織規章管理辦法」案 11. 本公司擬訂定「誠信經營守則」案 12. 本公司擬訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案 13. 本公司擬訂定「道德行為準則」案 14. 本公司擬訂定「公司治理實務守則」案 15. 本公司擬訂定「永續發展實務守則」案 16. 本公司擬訂定「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案 17. 本公司擬訂定「防範內線交易管理作業程序」案 18. 本公司擬訂定「內部人新就(解)任資料申報作業程序」案 19. 本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」案 20. 本公司擬修訂「資金貸與他人作業程序」案 21. 本公司擬修訂「背書保證作業程序」案 22. 本公司擬修訂「股東會議事規則」案 23. 本公司擬修訂「董事會議事規則」案 24. 本公司擬修訂「董事選舉辦法」案 25. 本公司 114 年度第一次股東臨時會召開事宜案
114 年 08 月 13 日	1. 本公司 114 年上半年度合併財務報表案 2. 更新本公司「薪酬委員會組織規章管理辦法」案
114 年 08 月 27 日 第一屆第一次	1. 本公司董事長選任案 2. 委任本公司第一屆審計委員會委員案 3. 委任本公司第一屆薪資報酬委員會委員案
114 年 09 月 14 日 第一屆第二次	1. 本公司稽核主管任命案 2. 董事及經理人薪酬討論案 3. 本公司擬變更印鑑保管人案
114 年 11 月 28 日 第一屆第三次	1. 本公司稽核報告擬由公司董事會授權一位獨立董事簽核案 2. 本公司 115 年度營運計劃案 3. 本公司擬訂定「非確信服務預先核准之審核辦法」

	4. 本公司 115 年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案 5. 本公司 115 年度簽證會計師委任及報酬案 6. 本公司自行編製財務報告能力自行評估案 7. 訂定本公司基層員工之範圍案 8. 本公司擬修訂「內部稽核實施細則」案 9. 本公司擬訂定「內部控制制度自行評估作業程序」案 10. 本公司擬修訂「內部控制制度」各類循環案 11. 本公司 115 年度稽核計劃案 12. 本公司擬訂定「內部重大資訊處理作業程序」案 13. 本公司擬修訂「防範內線交易管理作業程序」案 14. 本公司擬向兆豐國際商業銀行（以下簡稱兆豐銀行）申請中長期授信額度及短期授信額度案 15. 本公司財務長聘任案及財務主管暨發言人任命案 16. 審議本公司 114 年度經理人薪資報酬案 17. 審議本公司 114 年度經理人年終獎酬案
115 年 02 月 10 日 第一屆第四次	1. 審議本公司 114 年度經理人年終獎金報酬案 2. 擬訂定本公司「董事會及功能性委員會績效評估辦法」案
115 年 03 月 20 日 第一屆第五次	1. 本公司 114 年度營業報告書及財務報表(含個體及合併報表)案 2. 本公司 114 年度虧損撥補案 3. 擬辦理本公司已發行限制員工權利新股收回(買)註銷減資案 4. 本公司公司治理主管任命案 5. 政美應用(股)公司經理人名單案 6. 審議政美應用(股)公司 115 年度董事、獨立董事車馬費暨董事報酬案 7. 本公司擬向往來銀行申請授信額度案 8. 本公司稽核主管任命案 9. 114 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案 10. 本公司 115 年股東常會召開事宜案 11. 受理 115 年股東常會股東提案之相關事宜案
115 年 04 月 20 日 第一屆第六次	1. 超過正常授信期限之重大應收帳款是否視同資金貸與案 2. 114 年度營業報告書及財務報表(含個體及合併報表)案 3. 114 年度虧損撥補案 4. 本公司擬制定及修訂內部控制制度相關循環及其他管理辦法 5. 擬發行限制員工權利新股案 6. 擬向兆豐國際商業銀行(以下簡稱兆豐銀行)申請授信額度案 7. 改派政應(上海)科技有限公司子公司第一屆董事追認案 8. 擬指派代理發言人案 9. 擬變更 115 年度稽核計畫案 10. 政美應用(股)公司 2026 年經理人調薪案 11. 本公司擬修訂「永續發展實務守則」案 12. 解除新任法人董事代表人汪業傑先生，之競業行為之限制案

	13. 擬新增 115 年股東常會議案
--	---------------------

(十)最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

四、簽證會計師公費資訊：

(一) 簽證會計師公費資訊

單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	陳明輝	114.01.01~114.12.31	1,450	1,400	2,850	註
	蔡美貞	114.01.01~114.12.31				

註：非審計公費包含稅務報告查核簽證、內部控制制度專案審查作業等。

(二) 更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無。

(三) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

五、更換會計師資訊：無。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：

(一) 董事、監察人、經理人及大股東超過百分之十以上股東股權變動情形

職稱	姓名	114 年度		當年度(115 年)截至 4 月 13 日止	
		持有股數增 (減)數	質押股數增 (減)數	持有股數增 (減)數	質押股數增 (減)數
董事長 暨總經理	蔡政道	-	-	-	-
法人董事	大鵬投資股份有限公司	-	-	-	-
董事	陳五福	-	-	-	-
獨立董事	彭明秀	-	-	-	-
獨立董事	楊 千	-	-	-	-
獨立董事	葉維焜	-	-	-	-
獨立董事	莊柏年	-	-	-	-
財務長	周庭卉	-	-	-	-
技術長	黃朝瑜	-	-	(65,725)	-

資深處長	蔣仁主	-	-	(19,800)	-
會計主管	黃麗香	-	-	-	-

註：截至年報刊印日止，仍在任者。

(二) 董事、監察人、經理人、及大股東超過百分之十以上股東股權移轉之相對人為關係人之資訊：無。

(三) 董事、監察人、經理人及百分之十以上股東股權質押之相對人為關係人之資訊：無。

八、 持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二等親以內之親屬關係之資訊

115 年 4 月 13 日；單位：股；%

姓名	本人		配偶、未成年 子女持有股份		利用他人名 義合計持有 股份		前十大股東相互間具有關係人 或為配偶、二親等以內之親屬 關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	持有股份								
	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	名稱	關係	
							(或姓名)		
大鵬投資股份 有限公司	3,152,190	6.59%					蔡政道	代表人	-
創世投創股份 有限公司	2,440,000	5.10%					陳伯勳	代表人	-
元大商業銀行 受託保管政美 應用股份有限 公司員工有表 決權有股利分 配權之限制型 股票信託專戶	2,203,000	4.60%					-	-	-
陳伯勳	1,070,900	2.24%	396,313	0.83%			創世投創股份有 限公司	代表人	-
蔡政道	915,518	1.91%					大鵬投資股份有 限公司	代表人	-
元大證券股份 有限公司受託 保管 7 V A I 資本有限公 司投資專戶	897,000	1.87%					-	-	-
黃朝瑜	609,000	1.27%					-	-	-
李欣儒	564,749	1.18%							-
駿捷發有限公	564,455	1.18%					-	-	-

司									
林家榮	517,346	1.08%					-	-	-

註：上表持股基準日係以最近一次停止過戶基準日(115 年 4 月 13 日)之持有股數及已發行股份總數表達。

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例。

單位：千股；%

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及 直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
政應(上海) 科技有限公司	—	100.00%	—	—	—	100.00%

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

1. 股本形成經過

115年4月22日 單位：股；新台幣元

年 月	發行價格 (元)	核定股本		實收股本		備 註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款	其他
104/08	-	20,000,000	200,000,000	17,250,000	172,500,000	資本公積轉增資	無	註 1
105/06	20	20,000,000	200,000,000	19,750,000	197,500,000	員工認股權	無	註 2
107/10	20	50,000,000	500,000,000	22,000,000	220,000,000	現金增資	無	註 3
108/05	-	50,000,000	500,000,000	21,862,000	218,620,000	註銷庫藏股	無	註 4
109/01	20	50,000,000	500,000,000	26,362,000	263,620,000	現金增資	無	註 5
110/05	12	50,000,000	500,000,000	29,362,000	293,620,000	員工認股權	無	註 6
110/11	26	50,000,000	500,000,000	37,062,000	370,620,000	現金增資	無	註 7
113/12	28	50,000,000	500,000,000	38,472,000	384,720,000	員工認股權行使	無	註 8
114/01	28	50,000,000	500,000,000	39,562,000	395,620,000	員工認股權行使	無	註 9
114/05	10	80,000,000	800,000,000	41,925,000	419,250,000	限制員工權利新股	無	註 10
114/08	10	80,000,000	800,000,000	47,925,000	479,250,000	現金增資	無	註 11
115/04	10	80,000,000	800,000,000	47,865,000	478,650,000	收回註銷限制員工權利新股	無	註 12

註 1：變更登記日期文號：104.08.05 經授中字第 104336095102

註 2：變更登記日期文號：105.06.21 經授中字第 10533807490 號

註 3：變更登記日期文號：107.10.02 經授中字第 10733576300 號

註 4：變更登記日期文號：108.05.23 經授中字第 10833307520 號

註 5：變更登記日期文號：109.01.20 經授中字第 10933038450 號

註 6：變更登記日期文號：110.05.03 經授中字第 11033250180 號

註 7：變更登記日期文號：110.11.19 經授中字第 11033718500 號

註 8：變更登記日期文號：113.12.18 經授商字第 11331001850 號

註 9：變更登記日期文號：114.01.24 經授商字第 11430295750 號

註 10：變更登記日期文號：114.05.26 經授商字第 11430538690 號

註 11：變更登記日期文號：114.08.25 經授商字第 11430733280 號

註 12：變更登記日期文號：115.04.21 經授商字第 11530412910 號

2. 已發行股份種類

115年4月22日；單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	47,865,000	32,135,000	80,000,000	非上市(櫃)股票 (114/9/30 登錄興櫃)

3. 總括申報制度相關資訊：不適用。

(二) 主要股東名單

股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例

115 年 4 月 13 日；單位：人；股；%

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
大鵬投資股份有限公司		3,152,190	6.59%
創世投創股份有限公司		2,440,000	5.10%
元大商業銀行受託保管政美應用股份有限公司員工有表決權有股利分配權之限制型股票信託專戶		2,203,000	4.60%
陳伯勳		1,070,900	2.24%
蔡政道		915,518	1.91%
元大證券股份有限公司受託保管 7 V A I 資本有限公司投資專戶		897,000	1.87%
黃朝瑜		609,000	1.27%
李欣儒		564,749	1.18%
駿捷發有限公司		564,455	1.18%
林家榮		517,346	1.08%

註：上表持股基準日係以最近一次停止過戶基準日(115 年 4 月 13 日)之持有股數及已發行股份總數表達。

(三) 公司股利政策及執行狀況：

1.股利政策：

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司公開發行股票後，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金或股票之方式為之，並提報最近一次股東會。

本公司將考量公司所處環境及成長階段，因應未來資金需求及長期財務規劃，兼顧股東利益及平衡股利政策，每年就可供分配盈餘提撥不低於百分之十

分配股東股息紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本百分之十時，得不予分配；股東股息紅利得以現金或股票方式分派，其中現金股利之比例不得低於股利總數百分之十。

2. 本次股東會股利分派之情形：無

3. 預期股利政策將有重大變動時，應加以說明：無。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：無。

(五) 員工、董事及監察人酬勞：

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

公司年度如有獲利，應以當年度獲利狀況提撥不低於百分之十為員工酬勞，其中基層員工之員工酬勞分派比例應不低於該年度提撥為員工酬勞總數之百分之五；提撥不高於百分之三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項所稱年度如有獲利，係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。員工酬勞得以股票或現金為之，且發給股票或現金的對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。

2. 本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異之會計處理：

本公司 114 年度為累積虧損，故未估列員工酬勞及董事酬勞。

3. 董事會通過分派酬勞情形

(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異，應揭露差異數、原因及處理情形

本年度並無以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞，故不適用。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無此情形。

4. 股東會報告分派酬勞情形及結果

本年度並無以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞，故不適用。

5. 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理

情形。

前一年度並無以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞，故不適用。

(六) 公司買回本公司股份情形：無買回股份情形。

二、公司債(含海外公司債)辦理情形：無此情形。

三、特別股辦理情形：無此情形。

四、參與發行海外存託憑證辦理情形：無此情形。

五、員工認股權憑證辦理情形：

(一) 公司尚未屆期之員工認股權憑證主管機關申報生效日期、發行日期、發行單位數、發行得認購股數占已發行股份總數比率、認股存續期間、履約方式、限制認股期間及比率、截至年報刊印日止已執行取得股數、已執行認股金額、未執行認股數量、未執行認股者其每股認購價格、未執行認股數量占已發行股份總數比率及對股東權益影響：無。

(二) 累積至年報刊印日止，取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形。

單位：千股；新台幣千元；%

	職稱	姓名	取得認股數量	取得認股數量占已發行股份總數比率	已執行				未執行			
					認股數量	認股價格(元)	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率	認股數量	認股價格(元)	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率
經理人	董事長兼總經理	蔡政道	4,680	9.78%	4,680	@12 @20 @28	94,984	9.78%	-	-	-	-
	財務長	陳壽康										
	技術長	黃朝瑜										
	資深處長	林佳龍										
	資深處長	蔣仁主										
	會計主管	黃麗香										
員工	副總(註)	林秉毅	1,726	3.61%	1,726	@12 @20 @28	29,104	3.61%	-	-	-	-
	副總(註)	蔡杰										
	經理	林彥熙										
	副總(註)	施介皓										
	處長	許淳斌										
	副理	陳嚴燕										
	經理(註)	黃筠蓁										
	副理	林志遠										
	經理	洪哲珉										
	經理	羅烘鈞										

註：林秉毅於 113 年 9 月 30 日離職、蔡杰於 111 年 4 月 30 日離職、施介皓於 114 年 1 月 31 日離職、黃筠蓁於 113 年 5 月 31 日離職。

六、限制員工權利新股辦理情形：

(一) 凡尚未全數達既得條件之限制員工權利新股主管機關申報生效日期及總股數、發行日期、已發行股數、尚可發行股數、發行價格、既得條件、受限制權利、保管情形、未達既得條件之處理方式、已收回或買回股數、已解除限制權利之股數、未解除限制權利之股數、未解除限制權利之股數占已發行股份總數比率及對股權權益之影響：

限制員工權利新股種類	第一次(期)限制員工權利新股		
申報生效日期(股東會日期)及總股數	股東會日期：114/04/25 總股數：3,500,000 股		
發行日期	114/04/25		
已發行限制員工權利新股股數	2,363,000 股		
尚可發行限制員工權利新股股數	1,137,000 股		
發行價格	每股新台幣 10 元		
已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率	4.94%		
員工限制權利新股之既得條件	員工自獲配限制員工權利新股日起，其因分別達成以下既得條件後而得自由處分之股份比例如下：		
	既得條件		得自由處分之股份比例
	員工於被授與限制員工權利新股後在職服務連續滿一年，該年度績效考核達B+(含)以上，且該年度未有違反法令、勞動契約、工作規則或其與本公司間其他約定之情形		30%
	員工於被授與限制員工權利新股後在職服務連續滿二年，其中第二年度績效考核達B+(含)以上，且該年度未有違反法令、勞動契約、工作規則或其與本公司間其他約定之情形		30%
	員工於被授與限制員工權利新股後在職服務連續滿三年，其中第三年度績效考核達B+(含)以上，且該年度未有違反法令、勞動契約、工作規則或其與本公司間其他約定之情形		40%
員工限制權利新股之受限制權利	員工獲配新股後未達成既得條件前受限制之權利如下：		

限制員工權利新股種類	第一次(期)限制員工權利新股
	1.員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定負擔，或作其他方式之處分。員工符合既得條件後將依信託保管契約之約定，將該股份自信託帳戶撥付員工個人之集保帳戶。 2.股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等依信託保管契約執行之。 3.自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日、現金增資認股停止過戶日、公司法第 165 條第 3 項所定股東會停止過戶期間、或其它依事實發生之法定停止過戶期間至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其既得股票解除限制時間及程序依信託保管契約執行之。 4.限制員工權利新股發行後應立即直接交付信託機構或本公司指定之人信託保管。員工於既得條件未成就前，不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。
員工限制權利新股之保管情形	本公司將就員工獲配之股數登載於本公司股東名簿，並以實體股票或帳簿劃撥方式發給本公司新發行之普通股，並依信託契約約定，於既得條件限制期間內交付信託保管。
員工獲配或認購新股後未達既得條件之處理方式	(一)員工未達成既得條件之處理： 1.於獲配限制員工權利新股三年內自願離職、遭本公司免職或資遣、退休、個人自行請調關係企業者，就其先前已獲配但未達既得條件之股份（包含其股票股利），本公司將收回或收買該等股份辦理註銷，並返還原認購金額予員工；如有任何疑義，本公司並授權董事長依相關法令進行收回或收買該等股份之事宜，必要時，本公司之董事長並得決定及指示員工將該等股份以原認購金額轉讓予本公司指定之員工，或指示員工出售該等股份，並將因處分該等股票所取得之處分利益扣除原認購金額及相關支出之費用後給付本公司。 2.於獲配限制員工權利新股三年內經由本公司核准辦理留職停薪（包括但不限於育嬰、傷病、服兵役等）者，該員工於留職停薪期間均視為未達成既成條件。員工得於恢復原職務後依本條第(三)項之規定，於恢復原職務所在當年度可獲配股數之範圍內恢復權益。惟該員工恢復原職務之當年度可得實際獲配之股數，應由本公司董事長參酌第三條第(二)項之因素後，重新核定其達成既成得條件之比例及時限。 3.於獲配限制員工權利新股後，期滿第一年至第三年內之任一年

限制員工權利新股種類	第一次(期)限制員工權利新股
	度，未達本條第(三)項既得條件之規定者，就未達既得條件之股份（包含其股票股利），同本條第(四)項第1點之處理。 4.如因本公司營運所需，員工如經本公司要求並核定須轉任本公司關係企業者，就其於轉調關係企業生效日時未達既得條件之股份，本公司董事長得參酌第三條第(二)項之因素重新核定其既得條件之比例及時限。 5.若因職務調整，如晉升或轉任其他職務，則依新任職務的職責及未來貢獻潛力(本辦法第三條第(二)項所列考量因素)，於員工獲配之未達既得條件之股份範圍內，由本公司董事長重新核定其達成既得條件之比例及時限。 6.員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前之其他權利(包括但不限於:股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權等)，除不具現金增資原股東新股認購權外，與本公司已發行之普通股股份相同。惟股票股利分配亦併同交付信託保管，期限同原已信託保管股份。 7.既得條件未成就前，員工違反本條第六項、第七項或第八項之規定終止或解除對本公司或信託專戶受託人之委任代理授權，就未達既得條件之股份（包含其股票股利），同本條第(四)項第1點之處理。 (二)因受職業災害致身體殘疾或死亡，或有非職業災害致死亡(即一般死亡)之情形者，未達既得條件之限制員工權利新股依下列方式處理： 1.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，未達既得條件之限制員工權利新股，於員工離職生效日起即視為達成所有既得條件。 2.因受職業災害致死亡或一般死亡者，未達既得條件之限制員工權利新股，於員工死亡當日視為達成所有既得條件，由繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件，得以申請領受其應繼承之股份或經處分之權益。
已收回或收買限制員工權利新股股數	60,000 股
已解除限制權利之股數	0 股
未解除限制權利之股數	2,203,000 股
未解除限制權利之股數占已發行股份總數比率 (%)	4.6%
對股東權益影響	對公司每股盈餘稀釋情形：

限制員工權利新股種類	第一次(期)限制員工權利新股
	114 年至 117 年每股稅後盈餘影響金額分別為新臺幣 0.1325 元、0.1306 元、0.0625 元及 0.0151 元，對本公司每股盈餘可能之稀釋尚屬有限。

(二) 累積至年報刊印日止取得限制員工權利新股之經理人及取得前十大之員工姓名、取得情形。

115 年 4 月 22 日 單位：千股/新台幣千元

	職稱	姓名	取得限制員工權利新股數量	取得限制員工權利新股之股數占已發行股份總數比率	已解除限制權利				未解除限制權利			
					已解除限制之股數	發行價格(元)	發行金額	已解除限制之股數占已發行股份總數比率	未解除限制之股數	發行價格(元)	發行金額	未解除限制之股數占已發行股份總數比率
經理人	董事長暨總經理	蔡政道	935	1.95%	-	-	-	0%	935	@10	9,350	1.95%
	財務長暨資深副總經理	陳壽康(註)										
	技術長	黃朝瑜										
	資深處長	林佳龍(註)										
	資深處長	蔣仁主										
	會計主管	黃麗香										
員工	資深業務經理	王中原	545	1.14%	-	-	-	-	545	@10	5,450	1.14%
	技術經理	查名鴻(註)										
	經理	洪哲珉										
	專案經理	郭俊儀										
	處長	許淳斌										
	主任工程師	黃俊偉										
	經理	楊敬明										
	主任工程師	黃鈞巍										
	資深工程師	余傳勝										
	主任工程師	李長霖										

註：陳壽康於 114 年 11 月 30 日卸任、林佳龍於 115 年 03 月 10 日離職、查名鴻於 115 年 03 月 18 日離職。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

(一) 最近年度及截至年報刊印日止已完成併購或受讓他公司股份發行新股；無。

(二) 最近年度及截至年報刊印日止已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行新股；無。

八、資金運用計畫執行情形：截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 公司所營業務之主要內容：

CE01030 光學儀器製造業

CE01010 一般儀器製造業

CE01990 其他光學及精密器械製造業

CB01010 機械設備製造業

CC01080 電子零組件製造業

CC01110 電腦及其週邊設備製造業

F113010 機械批發業

F113030 精密儀器批發業

F113050 電腦及事務性機器設備批發業

F113060 度量衡器批發業

F401010 國際貿易業

I501010 產品設計業

JZ99050 仲介服務業

JA02010 電器及電子產品修理業

ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

2. 主要產品(服務)之營業比重：

單位：新台幣千元

產品(服務)	113 年度		114 年度	
	營業收入淨額	比重	營業收入淨額	比重
半導體晶圓級封裝檢測/量測設備 (Wafer Level Packaging)	158,610	50.57%	240,547	72.58%
半導體面板級封裝檢測/量測設備 (Panel Level Packaging)	100,218	31.95%	37,062	11.18%
化合物半導體檢測/量測設備 (Compound Semiconductor)	8,080	2.58%	6,476	1.96%
微型化發光二極體檢測/量測設備 (Micro LED)	28,800	9.18%	29,008	8.75%
發光二極體檢測/量測設備 (LED/MiniLED)	1,434	0.46%	-	0%
服務收入	16,508	5.26%	18,328	5.53%
合計	313,650	100.00%	331,421	100.00%

3. 目前之商品(服務)項目：

本公司以全/半自動化光學檢測與量測設備設計開發、製造、銷售與應用服務為主要

產品分類	商品(服務)項目
半導體晶圓級封裝檢測/量測設備 (Wafer Level Packaging)	先進封裝半導體8吋及12吋晶圓檢測與量測設備
半導體面板級封裝檢測/量測設備 (Panel Level Packaging)	多功能高產能半導體大尺寸面板自動化檢測與量測設備
化合物半導體檢測/量測設備 (Compound Semiconductor)	化合物半導體等檢測與量測設備
微型化發光二極體檢測/量測設備 (Micro LED)	微發光二極體4吋、6吋及8吋晶圓檢測與量測設備
發光二極體檢測/量測設備 (LED/MiniLED)	微發光二極體4吋、6吋及8吋晶圓檢測與量測設備
服務收入	因應設備銷售後所產生後續維護服務收入

4. 計畫開發之新商品(服務)：

本公司為了提昇元件的自製率、技術的自主程度以及產品的一致性，計劃開發下列項目：

A. 高階檢測、量測系統

- Horus：高解析度、高產出之 2D 檢測設備(High Sensitivity 2D Inspection)
- MetriX：高精度、高產出之 3D 量測設備，可應用於 $CD < 15 \mu m$ 之 μ Bump Wafer(CD/BH/COP, Die Warpage)

- iGague：高精度之量測設備(CD, Overlay, Die Shfit / Tilt / Rotate, Stack Height)
- iRIS：高穿透、無損之紅外線檢測設備(IR Die Crack Inspection)，應用 IR 穿透 Silicon 原理，精準檢測晶粒內部微裂痕(Die Crack, Sub-surface Defects)

B. 次系統

- 背檢站模組
- Wafer 翻轉模組

C. 光學模組

- PLR 多倍率及多波長模組
- IR 檢測模組
- TLI G2

D. 軟體生態系：

類別	功能
人工智慧模組 (Artificial Intelligence Module)	人工智慧模型平台 (AI Model Platform)
	線上 AI 模組 (Inline AI)
	離線 AI 模組 (Offline AI)
設備前端模組 (Equipment Front-End Module)	前端模組軟體 (EFEM Software)
	前端模組橋接軟體 (EFEM Bridge)
	自動化軟體 (Automation)
分析模組(Analysis Module)	分析軟體 (Analysis Software)
	缺陷覆判 (Defect Review)
	2D 檢測分析 (2D Inspection Analysis)
	3D 量測分析 (3D Measurement Analysis)

E. 自製多倍率鏡組整合自動對焦系統 (Auto Focus)

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

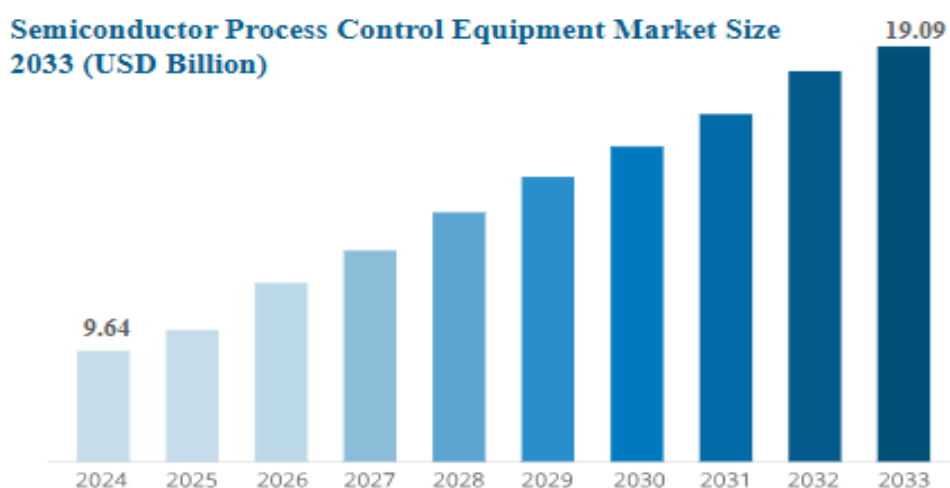
政美應用提供完整製程控制 (Process Control) 解決方案，產品涵蓋自動光學檢測

（Inspection）及量測（Metrology）設備，主要應用於半導體先進封裝、Micro LED及化合物半導體等高成長領域：

- 半導體先進封裝：針對扇外型晶圓級封裝（FOWLP）、扇外型面板級封裝（FOPLP），以及 CoWoS、CoPoS、2.5D／3D IC 等先進封裝技術，提供符合製程控制需求之檢測與量測設備，並可應用於重分佈層（RDL）及中介層（Interposer）等高階結構之缺陷檢測與關鍵尺寸（Critical Dimension, CD）量測，有效協助客戶提升製程良率及封裝品質穩定性。
- 微型發光二極體(Micro LED)：提供適用 4 吋、6 吋及 8 吋晶圓之檢測與量測設備，以因應微型化製程需求。
- 化合物半導體：支援氮化鎵（GaN）、碳化矽（SiC）及磷化銦（InP）等材料之製程控制應用。

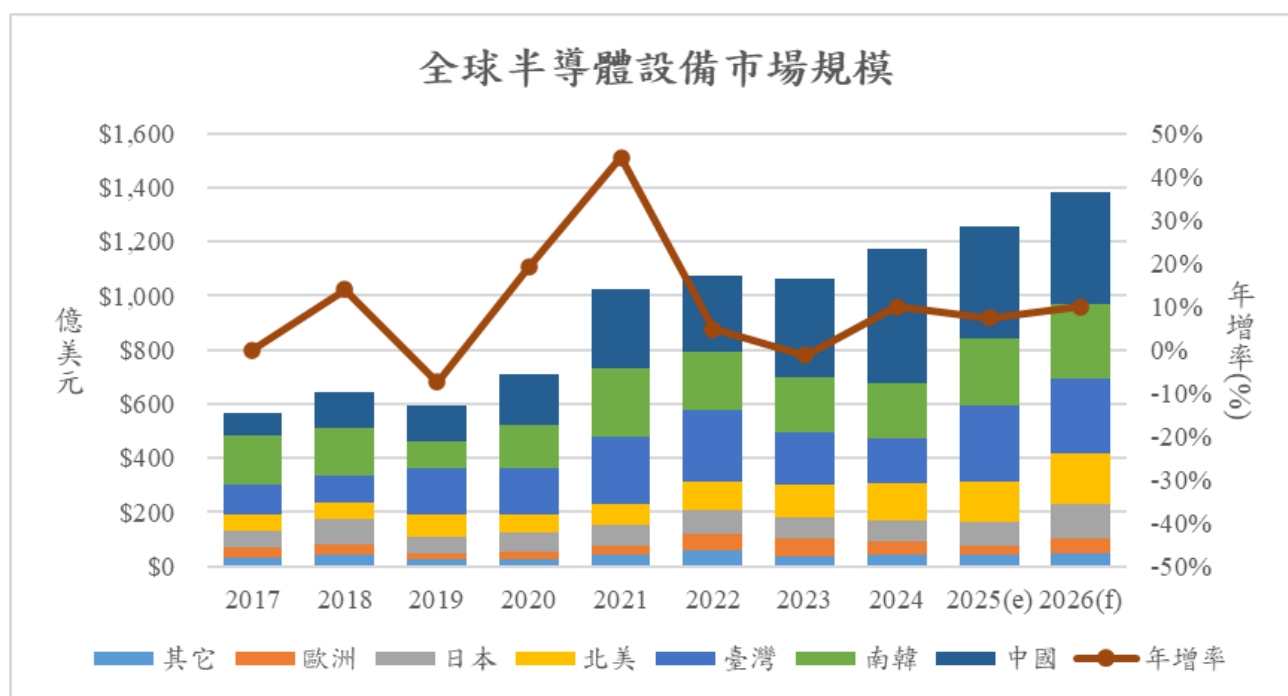
在終端市場需求的帶動下，半導體產業隨著產品應用中訊號傳輸頻寬與速度的不斷提升，進一步推動了 CoWoS、CoPoS、2.5D 與 3D IC 等先進封裝技術的發展。同時，微發光二極體（Micro LED）產業因晶片尺寸持續微縮，也對製程精度與設備提出更高要求。在萬物皆需晶片的時代背景下，晶片出貨量持續攀升，進而帶動半導體製程控制設備需求同步成長。市場預估，2025 年半導體製程控制設備市場規模將達 105.4 億美元，並於 2033 年成長至 190.9 億美元，年複合成長率（CAGR）為 7.9%。

圖 1.全球半導體製程控制設備市場規模



資料來源:Business Research Insight (2024)

圖 2. 全球全球半導體製造設備銷售總額



資料來源：SEMI

依據SEMI統計，受AI運算需求擴張、中國設備投資持續成長，以及DRAM與高頻寬記憶體（HBM）資本支出增加等因素帶動，全球半導體製造設備銷售規模可望持續提升。尤其隨高效能運算（HPC）、車用電子、工業應用與消費性電子需求逐步回溫，半導體測試及相關設備市場預期將進一步受惠。

隨製程技術朝微米乃至奈米等級演進，關鍵製程對臨界尺寸（CD）量測、錫球量測（如C4、Micro Bump、Pillar Bump）及微影覆蓋誤差（Overlay）等製程控制需求日益提升，帶動高精度檢測與量測設備成為先進製程不可或缺的重要環節。

以下針對政美應用公司所聚焦之半導體先進封裝、Micro LED 及化合物半導體等應用市場，現況說明如下：

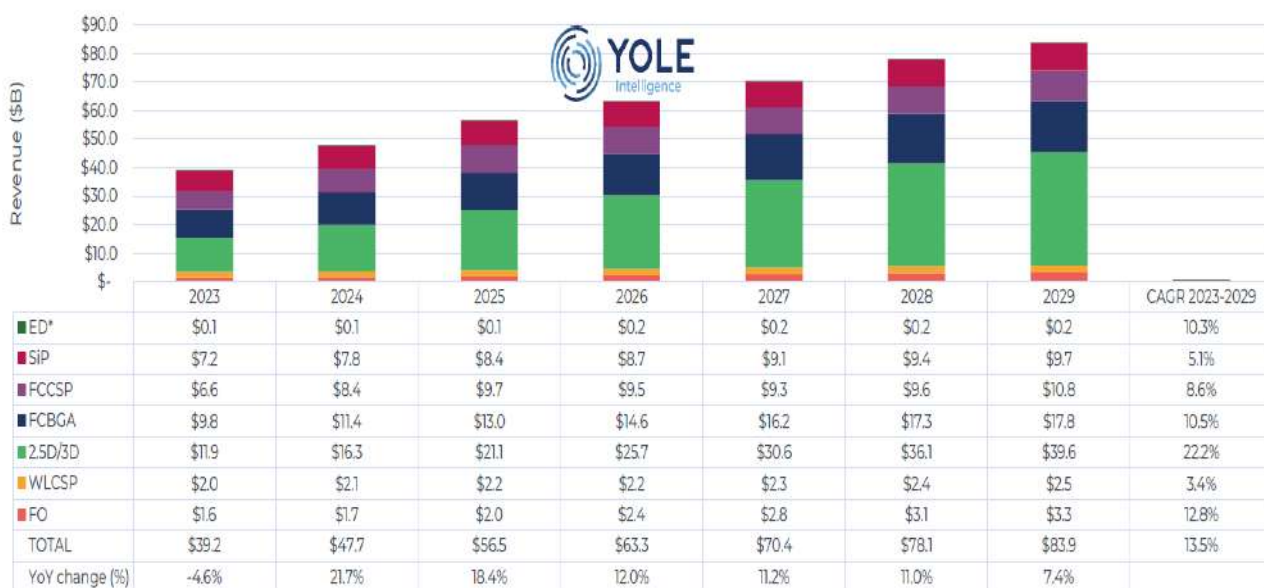
A. 半導體先進封裝

台灣在半導體先進封裝領域具全球領先地位。隨著高效能運算與異質整合需求增加，各類封裝技術持續發展，主要類型與技術說明如下：

類型	技術說明
----	------

嵌入式晶粒封裝 (Embedded Die)	指將一顆或多顆主動晶粒 (Active Die) 直接嵌入於封裝基板 (IC Substrate)、電路板或模塑材料中，而非傳統以焊接方式固定於基板表面。
系統級封裝(System In Packaging)	將 MCU、感測器、RF 模組等異質元件整合成單一模組，實現「微型系統」概念。
覆晶封裝 (Flip Chip Scale Package，以下簡稱FCCSP)	不同於傳統封裝方式，FCCSP 係將晶片翻轉後直接與封裝基板連接。
覆晶球閘陣列封裝 (Flip Chip-Ball Grid Array，以下簡稱FCBGA)	採用晶片倒裝 (Flip Chip) 技術，並透過錫球陣列 (BGA) 與電路板連接，適用於高效能與高 I/O 腳位數之應用產品。
2.5D與3D 堆疊晶片封裝 (2.5D/3D IC packaging，以下簡稱2.5D/3D)	2.5D晶片封裝：多顆晶粒並排放置於中介層 (Interposer) 上，透過 RDL 或 TSV (Through-Silicon Via) 互連。 3D晶片封裝：晶粒垂直堆疊，使用矽穿孔或微凸塊實現上下晶粒互連。
晶圓級晶片尺寸封裝 (Wafer Level Chip Scale Packaging，以下簡稱WLCSP)	晶圓階段完成封裝的技術，封裝後尺寸與晶片本身大小接近，不需再經過切割後再封裝的傳統流程，大幅簡化製程與降低成本。
扇外型晶圓級封裝 (Fan-Out Wafer-level Packaging，以下簡稱FOWLP)	不需使用傳統基板，直接於重分佈層 (RDL) 上延伸晶粒 I/O 腳位，達成更薄型化設計並提升電性與散熱效能。
扇外型面板級封裝 (Fan-Out Panel-Level packaging，以下簡稱FOPLP)	屬於扇外型晶圓封裝的進化版本。不同於傳統在晶圓上操作，FOPLP 將封裝作業移至更大的矩形面板 (Panel) 上進行，可有效提升產出效率並降低單位成本，具備量產優勢。

圖 3 先進封裝市場規模



資料來源：YOLE(2024Q4)

先進封裝市場需求預估至 2029 年可達 839 億美元，2023–2029 年複合年成長率（CAGR）約 13.5%。其中，2024 年受惠於 AI 與高效能運算（HPC）需求快速成長，帶動市場規模達 477 億美元，年增率（YOY）達 21.7%。在整體需求推動下，2.5D／3D IC 以及扇外型封裝（Fan-Out Packaging）成為主要成長動能，持續引領先進封裝技術發展。

a. 2.5D/3D 堆疊晶片封裝

先進封裝技術正朝向多維度與異質整合發展，透過將邏輯晶片、記憶體等不同功能晶片整合於單一封裝中，可有效提升運算效能並降低功耗，已成為 AI 與 HPC 晶片設計的關鍵技術方向。整體而言，先進封裝將持續朝高密度整合、更短訊號距離及更低功耗演進。

在 AI 與 HPC 高速運算需求驅動下，主要晶圓與封裝大廠已陸續導入 2.5D／3D IC 量產，並透過 RDL（重分佈層）作為晶片間訊號傳輸的關鍵橋接架構。相較傳統基板（substrate），線寬／線距可縮小約 4 至 5 倍，各廠商技術藍圖亦逐步推進至 2/2 μm 等級製程。線寬與線距的微縮，有助於提升 I/O 密度、縮短訊號延遲並強化整體系統效能，因此未來針對微米等級線寬線距的自動化量測技術將成為關鍵發展重點。

圖 4. 2.5D/3D 堆疊晶片市場規模

2.5D/ 3D Packaging Revenue (\$M): Technology (with CIS)



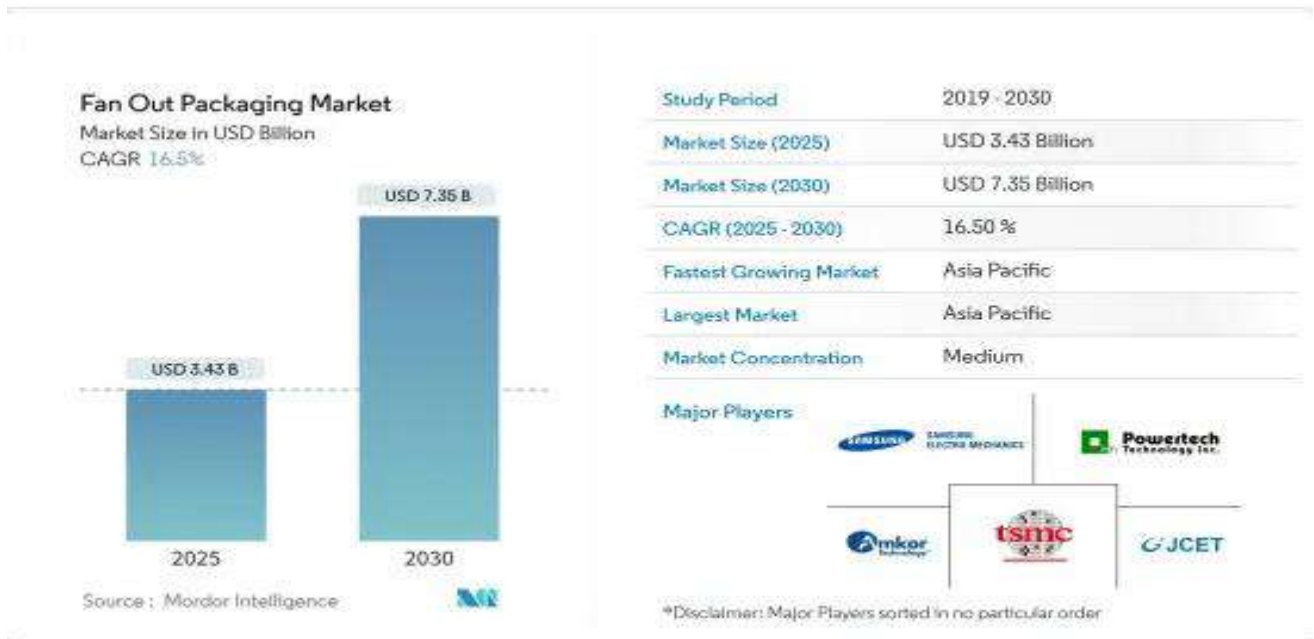
資料來源：YOLE(2024Q4)

根據 Yole 統計，至 2029 年 2.5D／3D 先進封裝市場總需求將達約 395.81 億美元，未來五年年複合成長率（CAGR）預估約 22%。其中，三維系統晶片（3D System on Chip, 3D SoC）、主動式矽中介層（Active Si Interposer）及模塑中介層（Mold Interposer）等細分技術，CAGR 皆可達 60% 以上，成長動能主要來自 AI、高效能運算（HPC）、資料中心、5G、車用電子及邊緣運算等新興應用需求。

a. 扇外型封裝（Fan-Out Packaging）

扇外型封裝相較於傳統扇入型封裝（Fan-In，如 Wire Bond BGA），具備更高的 I/O 密度、更優異的薄型化設計與散熱效能，因此特別適用於智慧型手機、高效能應用處理器（AP）、AI 晶片等對性能與空間配置要求極高的應用領域。

圖 5 . 扇出形封裝市場規模



資料來源：Mordor intelligence

扇外型封裝的營收目前高度依賴智慧型手機與消費性電子市場。根據預估，其市場規模將由 2025 年的 34.3 億美元成長至 2030 年的 73.5 億美元，於預測期間（2025–2030 年）之年複合成長率（CAGR）約為 16.5%。

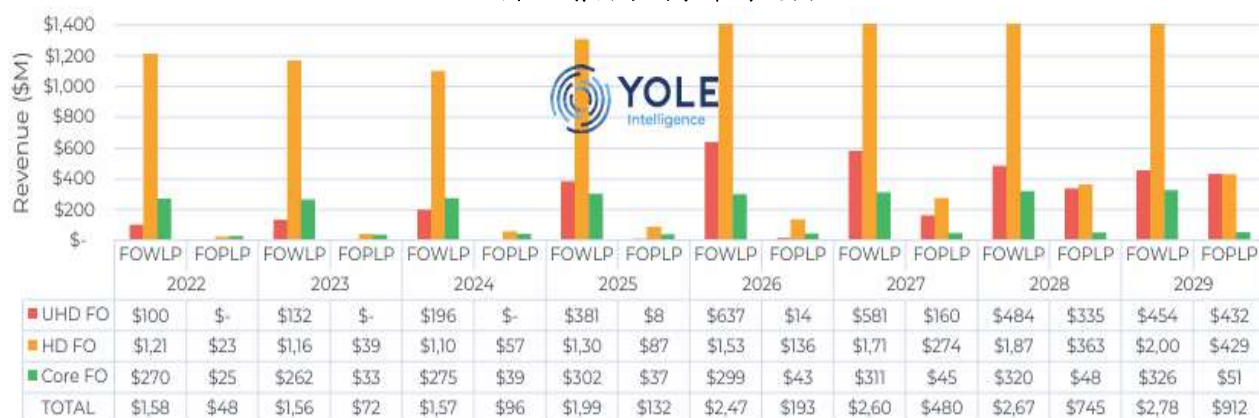
在市場需求持續擴大的帶動下，扇外型封裝技術亦逐漸形成以下三種主要發展趨勢：

類型	說明	對應層級	市場需求來源	技術關鍵
核心型扇出封裝 Core Fan-out (以下簡稱 Core FO)	屬於結合傳統有基板架構與 Fan-Out 技術的混合型封裝方式，在維持扇出封裝高 I/O 密度與薄型化優勢的同時，引入核心層或基板以強化結構支撐與電性表現。	中階應用（穩定/量大）	工控/車用市場。 主要用於通訊 IC、PMIC、控制器	成本控制 + 中等 I/O
高密度扇外型封裝 High Density Fan-Out (以下簡稱 HD FO)	介於一般 Fan-Out（如 FO-WLP）與更先進的 UHD FO 之間，適用於需要中高 I/O 數量、高效能傳輸與空間優化的中階至高階晶片應用。	高階手機 / 5G / 車用	行動裝置市場。 主要應用於高頻通訊、SoC 封裝	更細的 RDL + 多晶粒
超高密度扇外型封裝 Ultra High Density Fan-Out (以下簡稱 UHD FO)	Fan-Out 技術中最先進的一類，主要用於高效能運算（HPC）、AI 晶片、先進手機 SoC 等對 I/O 數量、頻寬、功耗要求極高的應用。	AI/HPC 等頂尖應用	AI/HPC 市場 主要應用於 AI GPU、NPU、Chiplet	超高密度、低功耗、高頻寬

資料來源：網路資料整理

隨著人工智慧（AI）與機器學習（ML）在各產業領域的應用快速擴展，市場對高效能運算（HPC）的需求亦持續攀升。受惠於雲端運算、5G 通訊、自動駕駛與 AI 晶片等應用推動，超高密度扇外型封裝（UHD Fan-Out）預期將在預測期間內成為先進封裝技術發展的重要主流方向，並引領整體封裝技術演進趨勢。

圖 6. 扇出形封裝市場規模



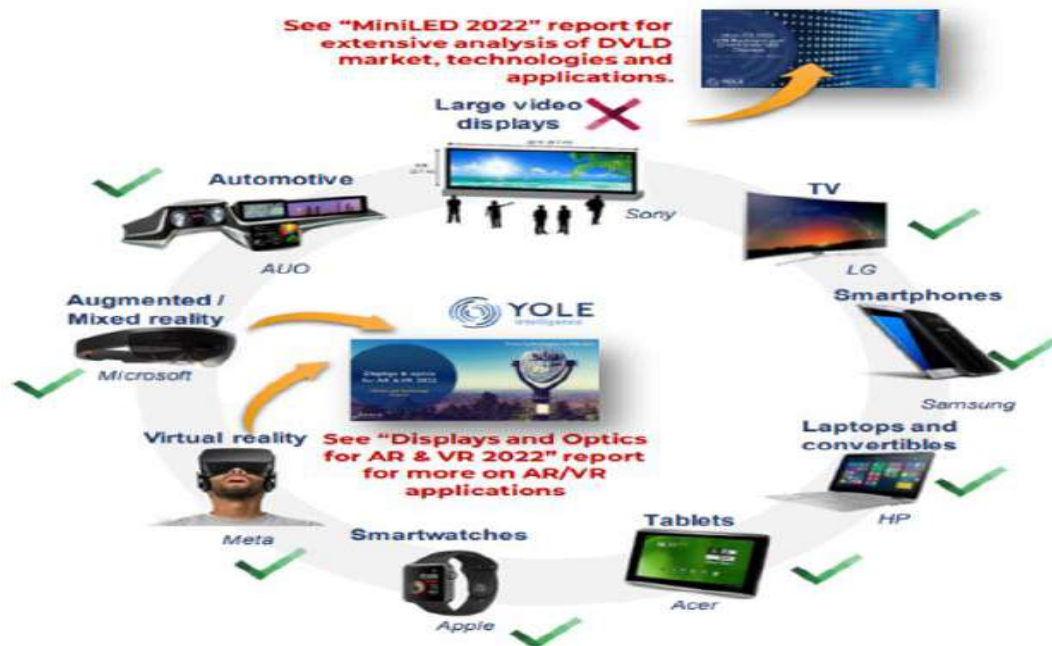
資料來源：YOLE(2024Q4)

「面板級扇外型封裝」（FOPLP）是以 FOWLP 為技術基礎，將封裝載板由傳統圓形晶圓改為方形面板設計，使同一面積內可配置更多晶片，不僅提升整體產能利用率，也能降低切割損耗，進而有效壓低製造成本。根據經濟部資料指出，FOPLP 採用面板級產線進行 IC 封裝時，方形基板利用率可達約 95%，並具備高 I/O 容量、尺寸更小、效能提升及功耗降低等多重優勢，已成為未來先進封裝的重要發展方向之一。此外，依據 Yole 市場調查顯示，高密度扇外型封裝（HD FO）需求持續維持成長趨勢；惟自 2026 年起，在 FOPLP 技術導入與應用擴大帶動下，市場將出現顯著成長動能，預估至 2029 年市場規模可達約 4.29 億美元。

B. 微發光二極體（Micro LED）產業現況

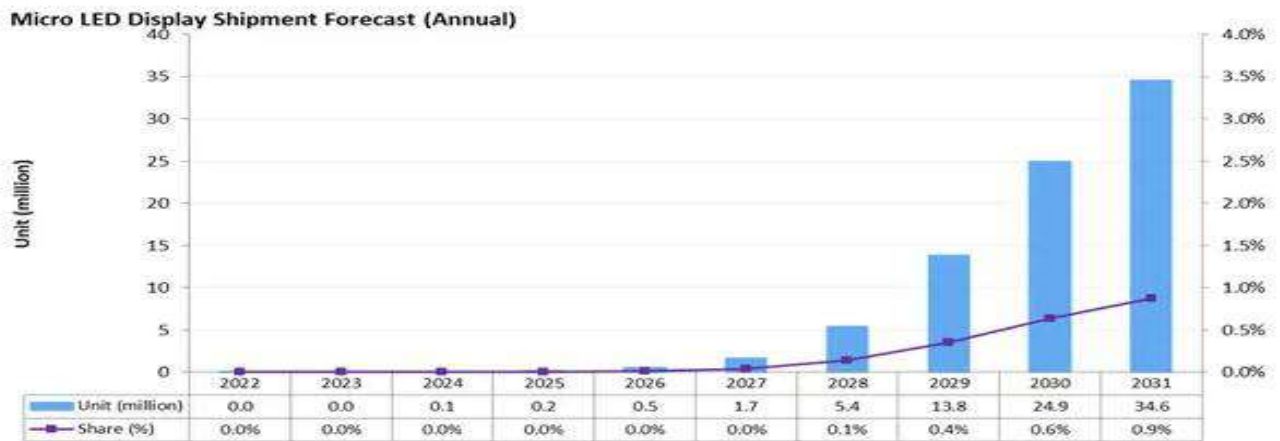
根據市調機構 Yole Développement 分析，隨著 Micro LED 技術與供應鏈逐步成熟，其應用範圍已擴展至手機、電視、筆記型電腦、平板電腦、穿戴式裝置，以及 AR／VR 等多元領域。其中，智慧手錶市場被視為率先成功商用的重要應用之一，並有望進一步推動高階電視、平板與筆電市場，提升相較於 OLED 的競爭優勢。雖然目前 Micro LED 在上述終端應用中的滲透率仍相對有限，但其同時具備 OLED 與 LCD 的關鍵優勢，展現高亮度、低功耗與長壽命等特性，使其被視為下一世代顯示技術的重要發展方向。此外，依據 Omdia 最新研究指出，Micro LED 顯示器出貨量預計將於 2031 年達到約 3,460 萬台，顯示該技術正逐步邁向規模化商業應用階段，市場成長動能明確。

圖 7 Micro LED 應用產品



資料來源：Yole / MicroLED 2022 Market and Technology Report (2022)

圖 8. Micro LED 出貨量預估



資料來源：Omdia

Micro LED 產業在台灣已形成完整且具規模的供應鏈聚落，涵蓋 LED 晶粒與磊晶製程、封裝技術、巨量轉移、驅動 IC、背板製造、模組組裝至最終系統整合等關鍵環節，產業體系相對成熟。隨著應用領域持續擴大，根據 Grand View Research Inc. 最新研究顯示，全球 Micro LED 市場規模預計於 2030 年達 256.5 億美元，2024 至 2030 年間年複合成長率（CAGR）高達 77.4%，展現強勁成長動能。整體市場成長主要受惠於 Micro LED 顯示技術的逐步普及，其相較傳統顯示方案具備更高能源效率，並可透過精準控制單一 LED 實現動態亮度調節，有效降低整體功耗。此外，隨著擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）技術投資與應用需求持續升溫，也進一步擴大 Micro LED 顯示器的潛在市場與應用機會。

圖 9. Micro Led 投資及技術

MICROLED FAB STATUS: INVESTMENT AND TECHNOLOGIES

									
Fab type	Greenfield μ LED	Greenfield μ LED	Greenfield μ LED	Greenfield foundry	Foundry partner	Greenfield μ LED	Greenfield μ LED	Greenfield μ LED	Greenfield mini/ μ LED
Display Type	Mass transfer & μ Displays	Mass transfer	μ Displays	μ Displays	μ Displays	Mass Transfer	Mass Transfer	Mass transfer	Mass transfer & μ Displays
Substrate platform	GaN-On-Si	Sapphire + GaAs	Sapphire + GaAs	GaN-On-Si	GaN-On-Si	Sapphire + GaAs	Sapphire + GaAs	GaN-On-Si	Sapphire + GaAs
Diameter	8" initially 12" long term	6" Initially	4"	8" initially 12" long term	12" target	8"	4", 6"	12" target	6"
Investment	Total: €340M	Est. \$339M	\$100M	NA	TBD	€800M	~\$50M	TBD	Est. \$190M & €100M
Status	€40M phase 1 end of 2022	2022 land & building acquired	In progress	Foundry partner	TBD	In progress	Completed	In progress	In progress
Scheduled ramp	2023 ramp 2024 MP	2025	2023	TBD (1 st foundry samples: 2023)	TBD (est.: post 2027)	2023 ramp 2024 MP	In operation	2024?	Ramping up
Chip processing		In house	In house		TBD	In house	In house	In house	In house
Partners					TBD				
Comments		MicroLED foundry Capa: 10k 6"/month	Bond 4" epitaxials on 12" CMOS	GlobalFoundries to build multi-purpose GaN fab.	Will likely use external foundry	Fab could produce other products	Capa: 1500-2000 6"/month	Could operate as μ LED foundry	Total fab investment: \$1.9B total fab.



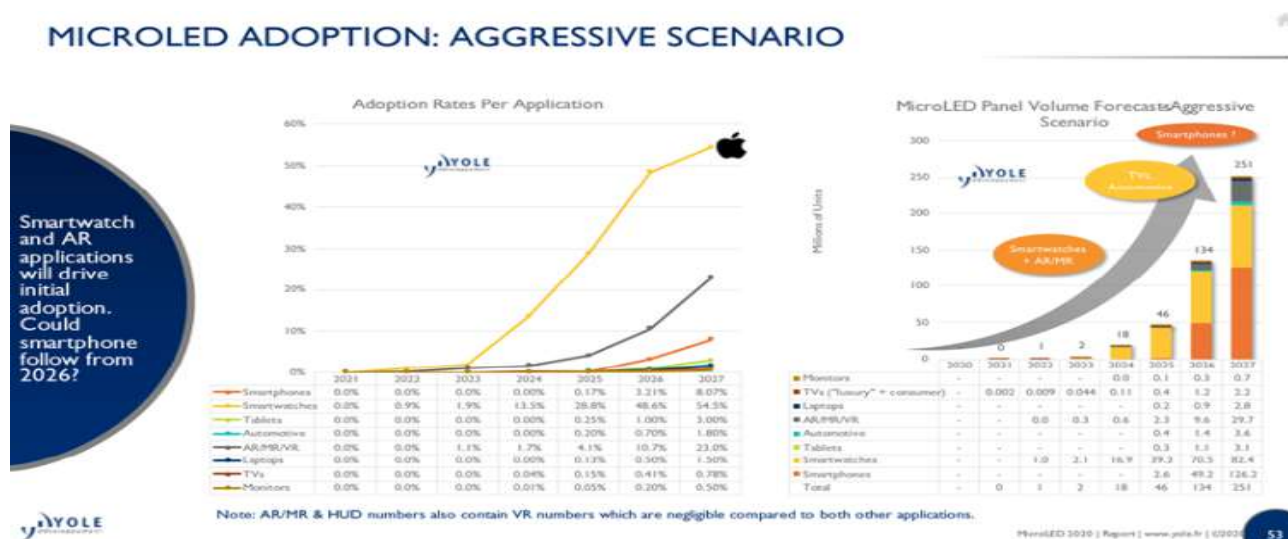
11 acquired Epistar in February 2022

MicroLED 2022 | Report | www.yolegroup.com | ©2022 | 26

資料來源：Yole / MicroLED 2022 Market and Technology Report (2022)

業界廠商經過多年技術投入與研發累積，Micro LED 大型顯示器已逐步邁入量產階段，並成為帶動相關零組件、設備及製程技術升級的重要推力。隨著產業參與者持續增加及製程朝微小化發展，將有助於進一步降低晶片成本，提升整體產業競爭力。同時，巨量轉移技術亦由傳統方式演進至更高效率與高利用率的雷射轉移方案，有效優化製程效率與成本結構。此外，隨著晶片廠積極擴建 6 吋外延產線並逐步釋出產能，Micro LED 晶片及整體製造成本可望持續下降。依據 Yole 市場研究報告，從應用面觀察，Micro LED 市場目前以智慧穿戴裝置（特別是智慧手錶）為主要需求來源，主要受國際品牌大廠（如蘋果）帶動；其次為 AR/MR/VR 等新興應用領域，預期具備最高成長潛力；第三則為智慧型手機顯示面板應用。若從晶片需求量角度分析，預估至 2027 年，Micro LED 晶片用量前三大應用將依序為智慧型手機、智慧穿戴手錶及 AR/MR/VR 裝置。此外，Yole 報告亦指出，自動駕駛車用顯示面板具備潛在發展空間，未來有望成為值得關注的成長機會。

圖 10 MicroLED 應用情境預測



資料來源：Yole / MicroLED 2022 Market and Technology Report (2022)

AR 智慧眼鏡被視為未來關鍵發展項目之一，亦為 Micro LED 技術的重要應用場域。然而，從技術與市場兩面向觀察，該產品仍面臨多項挑戰。在技術層面，AR 眼鏡須突破微投影與光波導等核心技術瓶頸，包括視場角（FOV）、解析度、亮度表現及光引擎設計等關鍵指標，其中光波導的亮度衰減問題尤為重要。在市場層面，AR 眼鏡仍需進一步驗證其對消費者與使用者的實質價值，以提升市場接受度。就光引擎需求而言，AR 裝置須具備小尺寸、高解析度與高像素密度（PPI）特性，通常需達 4,000 PPI 以上，因而要求 Micro LED 晶片尺寸縮小至 5 微米以下。儘管目前超微型 Micro LED 在發光效率、全彩化及晶圓整合等技術上仍處於發展初期，但其在高亮度與長壽命方面的優勢，使其仍為 AR 顯示技術的關鍵解決方案；相較之下，其他競爭技術（如 Micro OLED）在相關性能指標上仍具一定限制。

C. 化合物半導體

第三代與第四代半導體材料憑藉其優異特性逐漸崛起，主要包括能隙寬度介於 2.0 至 6.0 eV 的材料，如碳化矽（SiC）與氮化鎵（GaN）。其中，碳化矽具備高熱導率、高開關頻率、高電子遷移率及高擊穿場強等優勢，使其在效率與功率密度表現上顯著優於傳統矽基材料。因此，碳化矽元件特別適用於高電壓、高頻率及大電流之應用場景，廣泛應用於電動車與充電樁、5G 通訊、航太及新能源等領域，並隨著相關產業需求成長，持續展現強勁的市場發展潛力。

圖 11.全球功率半導體市場規模



資料來源：Yole

全球功率半導體市場規模預計將由 2018 年的 970 萬美元，大幅成長至 2028 年的 20.35 億美元，2018 至 2028 年間年複合成長率（CAGR）高達 49%，顯示整體市場處於高速擴張階段。其中，汽車與移動應用（Automotive & Mobility）將成為主要成長動能來源，預估至 2028 年其市場占比將超過 24%，且年複合成長率可達 110%，展現電動車與相關應用需求快速提升所帶來的強勁成長潛力。

2.產業上、中、下游之關聯性



3.產品之各種發展趨勢及競爭情形

A.產品之各種發展趨勢

a.自動化檢測設備高速發展

台灣晶圓製造、封裝與測試產業，穩坐全球之冠，各式材質與尺寸的晶粒開始朝向更大、更小兩極化、更薄以及 3D 堆疊的技術發展，傳統人工檢測行為受限於人力的訓練與判斷，加上製程工序的精密化與整

體晶圓的複雜度提升，人工檢測已成為耗時費力更甚至無法執行的缺點，於此情況下若以抽檢方式進行，檢驗率約小於 15%，然終端客戶對晶圓的檢驗率要求逐年提升，因此自動化檢測設備則成為生產線上能夠有效解決客戶要求、降低人工成本、提高出貨良率的必然趨勢。

本公司生產的「自動光學檢測設備」，具備晶圓與面板之全檢及抽檢等多元檢測功能，並結合自主開發之軟體與 AI 平台，整合各項製程與工程管控資訊。透過系統化與自動化的檢測流程，可有效提升產線良率與生產效率，同時降低整體製造成本，提供客戶完整且具效益之解決方案。

b. 自動化檢測與量測設備需求大增

隨著晶片功能與設計複雜度持續提升，且尺寸不斷微縮，對品質控管的要求亦日益嚴格，進而帶動晶圓檢測與量測需求的快速成長。特別是在半導體及微發光二極體（Micro LED）產業中，元件尺寸、錫球高度與直徑，以及晶粒貼附精度等關鍵參數，皆會直接影響產品效能與使用壽命。透過高精度量測設備，並整合晶片相關檢測數據，不僅可即時掌握製程狀態，亦能強化良率管理能力，進一步提升製程控制的精準度與應用價值。

本公司生產的「自動光學檢測與量測設備」可提供晶圓及面板全檢/量、抽檢/量等廣度應用，透過自主開發的軟體平台整合 2D 檢測及 AI 辨識覆判分類、2D 量測與 3D 量測等資訊，提供各式工程分析數據與參數卡控，達成多樣化檢測與量測工具的一體化到位，有效提升設備利用率與生產良率改善，並透過高產速來達成產線的效率。

c. 設備國產化需求

半導體與微發光二極體產業長期為台灣重要優勢領域。然而，目前國內主流使用之自動化檢測與量測設備多仰賴進口，不僅成本高昂，後續維修不易，客製化服務亦較難即時因應需求。為強化關鍵設備供應自主性與穩定性，工研院量測技術發展中心於 2004 年成立「自動光學檢測設備聯盟」，推動國內產業整體發展策略。此外，經濟部亦於 2021 至 2022 年間編列約 2.5 億元預算，推動關鍵半導體設備國產化，顯示政府對相關產業自主能力的高度重視。

本公司所生產之自動化光學檢測與量測設備，自主化程度達 80%

以上，整合光學光路設計、機構自動化運動控制及自有軟體平台系統。其中，軟體平台採自主研發之 MOON 系統，具備高度擴充性，可完整支援各項檢測與量測功能開發與系統整合。透過關鍵技術的全面掌握，本公司可提供客戶完整的 Total Solution，已成功導入國內外多家一線晶圓代工及封裝大廠之製程檢測應用。未來將持續深化國內市場布局，並積極拓展海外市場，推動台灣自動化檢測與量測設備走向全球應用。

4. 產品之競爭情形

自動光學檢測設備市場主要競爭者包含國際大廠如 KLA、Camtek、Onto、Toray 等，以及國內廠商如由田科技、牧德科技等。相較之下，國際設備商產品價格普遍較高，通常為台廠的兩倍以上，且多數較少針對特殊客製化需求進行功能調整與開發。本公司則強調合作與聯盟之經營理念，透過強化與客戶端的技術溝通，以及與供應鏈夥伴的協同開發，精準掌握市場需求痛點，以高品質產品與服務標準，為整體供應鏈創造更高附加價值，實現永續經營目標。本公司歷經市場長期驗證，產品品質及檢測良率已獲半導體、面板及 Micro LED 等產業客戶肯定。公司成立於 1995 年，初期以設備代理為基礎逐步深耕市場，並透過自主技術整合，於 2001 至 2009 年間成為中國地區 LED 檢測設備市占率第一之廠商。2010 年起成功開發自動化高階檢測設備，進一步切入半導體先進封裝及 Micro LED 產業；2020 年產品成功導入蘋果供應鏈；2022 年獲國際研究機構 Yole 列為 Micro LED 顯示面板檢測設備主要供應商之一；同年亦持續取得多項國際大廠訂單。自 2024 年起，更正式成為重要客戶指定之晶圓表面檢測設備供應商，持續獲得海內外客戶高度肯定。

(三) 技術及研發概況：

1. 所營業務之技術層次、研究發展

本公司深耕 2D 與 3D 自動光學檢測 (AOI) 及量測領域，自創立以來，始終將「自主研發」與「持續創新」視為企業永續發展的基石。憑藉多年的龐大研發量能、深厚的產業鏈經驗以及與客戶的長期緊密合作，我們已淬鍊出高度成熟且領先業界的八大核心技術：

A. 光學、機構、電控、軟體之整合應用

B. 軟體以及 AI 檢測覆判平台，快速應用於不同產業

- C. 光學模組開發
- D. 自動化模組開發
- E. 缺陷瑕疵檢查技術
- F. 高精度量測
- G. 高度客製化需求開發
- H. 智慧製造流程開發設計能力

基於以上的能力，研發人員對於客戶的需求都能給予快速的回饋，且不會只滿足於現狀，技術能力仍不斷地向上提升，以提高檢測精度及速度。除提升技術的深度外，更朝著技術應用的廣度前進，全方位善用本公司的技術核心，提供客戶更完整的解決方案，與客戶創造雙贏。

2. 最近年度投入之研發費用

單位：新臺幣千元

年度 項目	113 年	114 年
研發費用	145,849	161,888

3. 最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品 研發:

年度	項 目
107	Driver IC表面檢查機(8"/12")、軟體模組(EBR、GDS、Bare Wafer)
108	Micro LED COW/COC表面檢查機、6"晶圓正/背表面檢查機(車用IC)
109	晶圓高速3D量測機、Mini LED晶粒正/背檢查機、MicroLED PL檢查機、軟體模組(MetrologyX、GDS、Multi-Die)
110	低成本Wafer表面檢查機、Micro LED PixeLED Matrix檢查機、自製Pre-Aligner
111	RDL 2/2 晶圓檢查機、自製多倍率光學系統、大口徑PL光學系統、AI複判系統、S700表面檢查機(車用)
112	高精度Wafer治具(PL用)、Micro LED G3.5背板檢查機、Micro LED Sub-Panel線路檢查機、μLED Sub-Panel Bevel檢查機(使用AI)
113	SiPh晶圓檢查機、FOPLP 700檢查機(科專)、Recipe Server、Tool Matching、PLR+、TLI+、高精度3D(μBump用)
114	Argus 3000 Series for Panel 310、PLR HS、Software Ecosystem、

(四) 長、短期業務發展計畫：

1. 短期業務發展計畫

A. 聚焦高成長應用市場，加速產品導入

針對先進封裝半導體、扇外型面板級封裝、MicroLED 穿戴與顯示應用、未來高階玻璃 IC 載版等高成長領域，強化既有產品性能、提升量檢測解析度與產能表現，加速新世代自動化檢測與量測產品的市場導入與驗證，擴大營收來源。

B. 深化與一線客戶協作，加速導入與優化

積極與晶圓廠、封裝廠，面板大廠合作，透過客製化專案導入與快速迭代，提升產品適應性與量產穩定性，建立口碑與實績，進一步提升在替代外商設備上的競爭力。

C. 建構跨部門協同的技術服務體系

優化研發、業務與技術服務團隊的協作流程，導入系統化客戶回饋與現場支援機制，縮短問題反應與解決時間，以高效率與高品質的技術支援，提升客戶滿意度。

D. 強化品牌形象與國際能見度

積極參與國際展會、技術研討會與產業交流活動，累積品牌認知度與信任感，結合官網、影片與客戶成功案例建立完整品牌形象，為中長期全球市場布局奠定基礎。

2. 中、長期發展計畫

A. 成為關鍵製程升級的解決方案領導者

本公司將以高精度、高速度、高穩定性的光學檢測與量測技術為核心，持續投入先進製程所需關鍵量/檢測設備之研發，涵蓋 2.5D/3D IC 封裝、Micro LED 晶片轉移與量測、扇外型面板級封裝、以及高階 IC 載板檢測等領域，成為客戶進行製程升級的首選合作夥伴，並深化與全球一線晶圓、IC 封測大廠、面板及 Micro LED 廠、與 IC 載版廠的合作關係。

B. 建立台灣自主技術與國際接軌的關鍵橋梁

強化自有研發能力，逐步取代進口設備，打破國際大廠在高階檢測與量測設備的市場壟斷，藉由導入 AI 演算法、3D 量測與智慧工廠系統，協助客戶完成產線智慧升級與產能優化，實現國際接軌，並進一步打入東南亞、韓國、日本與歐美等市場。

C. 建構平台型技術生態系，導入軟硬整合服務

未來將結合硬體設備、量測演算法、數據分析平台與即時監控系統，提供客製化 Turnkey 解決方案，提升產品附加價值與黏著度，推進產品朝「平台型智慧檢量測系統」發展。

D. 永續經營與專業人才培育

透過強化技術本土化、專利布局與技術轉移制度，配合政府產業升級政策，致力於培育下一代檢測與量測系統人才，確保技術與營運具備永續性，實現產業與社會價值雙贏。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣千元

年度 銷售地區	113 年度		114 年度	
	銷售金額	比重	銷售金額	比重
台灣	214,345	68.34%	265,624	80.15%
中國大陸	97,348	31.04%	65,768	19.84%
其他	1,957	0.62%	29	0.01%
合計	313,650	100%	331,421	100%

2. 市場占有率

本公司研發、產銷自動化檢測與量測設備，目前國內外未針對此項產業分類提出市場占有率調查報告，故本公司就往來客戶與其同業之機台採用情形，說明公司產品於國內市場占有率以及同業競爭情形：

A. 半導體晶圓自動化光學檢測與量測設備

本公司生產之自動化檢測與量測設備針對先進封裝半導體市場進行開發與布局，從 Bare Wafer、Patterned Wafer、Film Frame、Panel 製程皆能對應開發，並有包含 12" 晶圓至 700*700 mm Panel 皆能自動化進行

檢測與量測功能，因此國內客戶半導體及面板大廠皆有採用本公司生產之機台。

B. 微發光二極體及顯示面板自動化光學檢測與量測設備

本公司生產之自動化檢測與量測設備針對微發光二極體市場進行開發與布局，從 Bare Wafer、Patterned Wafer、Film Frame、Panel 製程皆能對應開發，並有包含 6"晶圓至 700*700 mm Panel 皆能自動化進行檢測與量測功能，因此國內客戶關鍵大廠皆有採用本公司生產之機台。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

A. 半導體晶圓自動化光學檢測與量測設備

國際半導體協會 SEMI 在公布的全球晶圓預測報告中指出，半導體設備投資總額已達到 1,000 億美元；根據經濟部 2022 年 9 月報告指出，國際大廠在台研發投資金額達 243 億元，成為歷史新高，可見市場對於半導體設備的需求帶動研發技術的成長。

本公司生產之自動化檢測與量測設備應用於半導體先進封裝製程中，除能達到 Bare Wafer、Pattern Wafer、Film Frame Wafer 等晶圓進行檢測與量測，更能針對 RDL 2um/2um 細線路缺陷進行檢測，量測部分則包含 2D 影像的量測技術與 3D 量測部分對關鍵尺寸、Bump 進行量測 (μBump、Pillar Bump、C4 Bump 等)，除此之外本公司還提供大尺寸面板類型的檢測與量測設備，為客戶提供全方位的 Total Solution，使檢測速度與良率優化，並透過高精度與多功能的軟體演算法，創造高價值的產品與設備體驗。

B. 微發光二極體及顯示面板自動化光學檢測與量測設備

Micro LED 經過多年的市場耕耘，目前已逐漸成熟，並針對新型顯示技術取得關鍵性突破，從研發走入消費者市場，大尺寸顯示器亦開始量產，廠商不斷加入與持續微小化的發展趨勢勢不可擋，皆將使 Micro LED 晶片成本下降並擴大應用領域，包含智慧型手機、電腦與平板、穿戴裝置、AR/VR/IR 等。TrendForce 集邦諮詢預期，從 2023 到 2026 年，複合成長率可達 700%。

本公司生產之自動化檢測與量測設備應用於微發光二極體領域，提供整線的智能串聯，包含 EPI Wafer、COW (Chip on Wafer)、COC (Chip on

Chip)、QDCF、Panel AOI...等，皆能有對應的自動化檢測與量測功能，並針對 Micro LED 百萬等級的晶片數量進行高效的運算與判斷，達到良率提升與工程分析的改善，為整體微發光二極體之產業鏈提供技術突破之關鍵。

4. 競爭利基

政美應用股份有限公司「以創新技術提供卓越的 AOI 解決方案，給予客戶高價值的體驗，使 CMIt 成為最受尊敬的國際品牌」為使命，聚焦先進封裝、Micro LED、化合物半導體與面板等市場，期盼能夠達成見微知著、精益求精、脫穎而出、共創多贏的格局。

A. 自主技術程度達 80%以上

以世界領先的技術與解決方案為基礎，在光學、機構、運動控制、2D 檢測/量測、3D 量測等系統進行開發與整合，再透過自主開發的軟體平台 MOON (Multi Orientation Optical Navigation) Platform，朝向 iiAOI (Integrate Intelligent Automatic Optical Inspection)的目標前進，整體設備技術自主化程度達 8 成以上，秉持服務精神，提供深獲客戶夥伴信賴的專業知識和解決方案服務。

B. 台灣唯一自主研發半導體晶圓級先進封裝(Wafer Level Packaging)

Turnkey Solution 之先進技術檢測與量測設備供應商

針對半導體 CD 2/2 μm 線寬製程，提供國內自主研發兼具高瑕疵檢出率、高穩定與高速之晶圓封裝檢測設備，克服目前國內市售產品不足與國外技術壟斷的限制，更延伸此技術至矽中介層 (Si Interposer) 領域。可藉由各項技術的研發，培育政美應用於此相關領域的專業人才，對於國內產業的技術深化，推動檢測與量測一體整合之設計，切入先進封裝龍頭大廠，與客戶建立共贏合作模式。除優化產品自主開發能力並結合 AI 進行大數據智慧化分析，改善製程良率，達到先進封裝製程 8P/8M Total Solution，技術涵量將媲美國際大廠 Onto、KLA 等之製程檢測技術能力，展現國產化自主製造能量且並符合終端廠需求，提高產品品質與附加價值，同時取代國際大廠，成為台灣第一家高階先進製程檢測設備商，更是高階檢測設備國產化的指標企業，積極提昇國產設備市佔率，打入國際市場。

C. 業界唯一自主研發同時提供面板級先進封裝(Panel Level Packaging)

檢測與量測結合技術之設備供應商

目前國內外有眾多自動化光學檢測設備、自動化光學量測設備競爭者，但皆於各自領域發展，無法提供整合性產品，惟本公司透過自主研發多年的 MOON (Multi Orientation Optical Navigator)系統，整合多項光學應用與控制，並可跨站點提供全站式/全線的製程分析能力，使檢測與量測行為達到最佳化的效率與品質，目前在市場上較無相同之競爭對手。

在 Micro LED 產業，延伸 Micro LED Chip 至 Micro LED Panel，跟隨台灣第一的 Micro LED 技術領先大廠深耕布局多年，不僅做為設備設計應用開發者，更針對 Micro LED 產業整體所面臨的檢測趨勢提供進一步的解決方案，並於 2022 年成為國際市場研究機構 Yole 在報告中名列的 Micro LED 顯示面板製程設備主要供應商之一，建構一枝獨秀的「TurnKey Solution」競爭力。

綜上所述，半導體產業對於精度、速度的要求需要較長的認證期，以及不同客戶、不同製程的專業客製化需求，本公司一一克服並取得龍頭大廠的認可，此皆為本公司多年經營成果及隨之帶來的競爭利基，且於發光二極體領域更在業界脫穎而出，這都是其他後進廠商乃至競爭對手須面對的進入門檻。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

有利因素	● 自動檢測與量測需求擴大 半導體產業隨著產品應用訊號傳輸及頻寬和速度的提昇，促進 2.5D、3D IC 的發展，加上微發光二極體產業 Chip 的微小化等因素，在這個處處需晶片的時代，5G、車用、智慧型手機螢幕、穿戴裝置、大型電視牆等，擴大了電子產品的應用，帶動了整體市場的需求提升，持續攀升的晶片出貨量帶動上游設備需求增加，以自動化設備取代人工肉眼檢查為未來趨勢，本公司致力於自動化檢測與量測設備之開發，拓展設備的應用領域，發展出功能多元與品質優異的設備，積極行銷以掌握市場潮流。 ● 政府推動半導體設備國產化 台灣半導體產業在全球居領先地位，惟台灣晶圓廠 2024 年設
------	--

	備投資約 230 億美元，政府將攜手台灣電子設備協會與產業，進一步推動半導體設備國產化。因此，經濟部工業局長期致力於推動國內半導體設備及零組件產業升級，透過「光電及半導體設備產業發展計畫」、「先進封裝設備計畫」、「電子設備展業推動計畫」等專案，提升國內相關設備與零組件自製能力，減少進口設備依賴，藉以降低國內半導體終端業者生產成本。 而本公司從研發自主軟體、光學光路設計、自動化控制等至今已有多多年，在研發人力的布局更達公司總人數一半以上，因此在面對各半導體開發總部訂單需求時，可以敏捷的評估並且設計製造出最符合客戶需求的設備，與國內知名大廠客戶有密切的合作，此為國際大廠難以企及的競爭優勢。
不利因素	● 大陸廠商積極投入並採取低價搶市策略 根據經濟日報整理之 SEMI 和 Trendforce 資料，預估 2025 年全球晶圓產能分佈以中國大陸為大宗(月產 1,010 萬片)，其次則為台灣(月產 580 萬片)，第三就是韓國(月產 540 萬片)。2024 年中國半導體檢測設備市場規模已經達到了 194.5 億人民幣。量/檢測設備是半導體製造重要的品質檢查工藝設備，價值量占比較高。預計 2025 年中國大陸量/檢測設備市場規模將達到 208.9 億人民幣，市場需求較為廣闊。中科飛測、上海精測、睿勵科學、東方晶源等中國廠商雖已經實現一定突破，但量/檢測設備仍是前道國產化率最低(2024 年底其國產化程度約為 5%)的環節之一。未來在大陸政府的鼓勵下，集團的大量投資皆使中國大陸成為可敬可畏的對手。 ● 產業特性導致營收認列期間較長，致營運資金規劃難度高 因應會計收入認列原則之規範，設備業在設備銷售過程中須通過一定的程序才能完整認列營收，尤其在新機種導入時更需較長且時間不確定之驗收期，因此隨著營收規模增長，恐將面臨大量的營運資金準備。 ● 技術人才招聘不易

	近年來科技產業缺工情形連年未解，再加上竹科等半導體產業磁吸效應，技術人才招聘上較為不易。
因應對策	● 明確產品定位，持續投入研發新品 本公司為因應大陸及其他廠商競爭，除明確產品定位，不與大陸地區低價產品競爭，此外也持續投入開發新產品，並取得相關專利，創造與大陸業者乃至海外競爭廠商之差異化。 此外本公司不論在半導體先進封裝、Micro LED、面板業皆有 Tier 1 之客戶認證，提供多業態設備，因此較不受其他競爭對手切入任一行業後對營收有顯著衝擊，多角化經營降低對單一產業的依賴及特定產業景氣循環對本公司營收穩定性的影響。 ● 收款政策的調整 本公司為降低營運資金壓力，針對不同客戶制定不同的收款策略，分階段向客戶收取訂金、交機款及驗收款等款項，除符合會計收入認列時點外也穩定公司之金流。此外，也將透過進入資本市場增加多元籌資管道，以滿足公司營收成長所需資金。 ● 健全工作環境，建立良好薪酬制度 為因應人才招聘不易狀況，建立良好之薪酬、實施員工獎酬制度，健全工作環境，落實紮實之教育訓練，藉以提升各方面的吸引力，增加員工留任率及向心力。

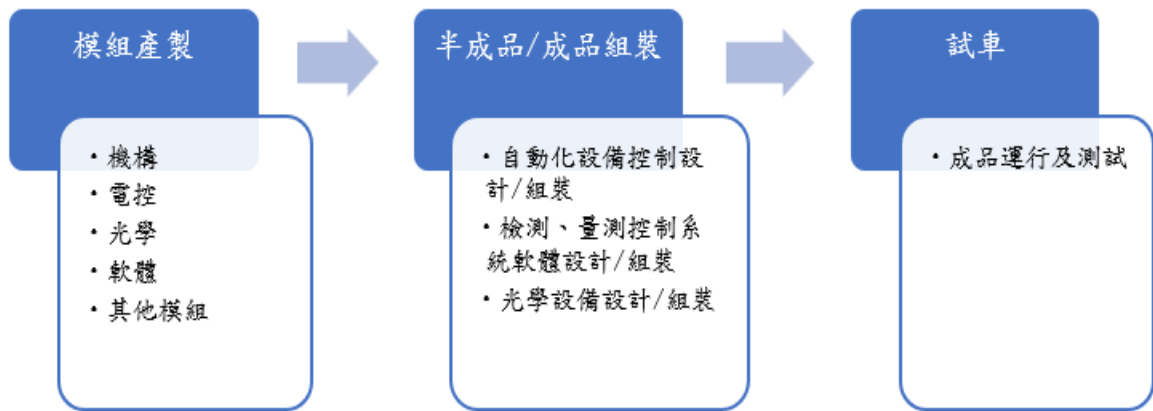
(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途

本公司主要產品為自動化光學檢測與量測設備，主要是指使用光學技術來自動檢查產品外觀、尺寸、表面缺陷，或者做高精度量測的設備。惟隨著晶圓尺寸逐漸放大，製程與晶粒的不斷縮小，晶圓瑕疵檢測速度也越發被注重，以機器視覺透過無接觸的方式對晶圓做光學檢測與量測行為，達到全片的檢測與量測，更可透過演算法、AI 等運用達到降低人工複檢的

缺失，提高整體產線的製程資料保留與分析，改善製程良率，提供快速又能降低人力成本的全方位解決方案。

2. 主要產品之產製過程



(三) 主要原料/零組件之供應狀況

本公司產製之自動化光學檢測與量測設備，其主要構件可分為光學件、市購件及加工件，與主要原料及零組件進貨廠商均維持長期合作關係，並往來多年，配合關係良好，供貨情形穩定，並無供應短缺或斷料之情事發生。

(四) 最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進（銷）貨金額與比例，並說明其增減變動原因：

1. 最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，並說明其增減變動原因：

單位：新台幣千元

項目	113年度				114年度			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	廠商B	33,102	14%	無	廠商A	37,668	14%	無
2	廠商A	30,826	13%	無	廠商B	30,409	11%	無
3	其他	173,787	73%	-	其他	210,115	75%	-
	進貨淨額	237,715	100%	-	進貨淨額	278,192	100%	-

增減變動說明：

廠商 B 公司比例下降，主因係其他廠商之原料需求增加所致。

2. 最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，並說明其增減變動原因：

單位：新台幣千元

項目	113年度				114年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	客戶A	159,213	51%	無	客戶A	220,383	66%	無
2	客戶B	65,218	21%	無	客戶B	0	0%	無
3	客戶C	5	0%	無	客戶C	61,657	19%	無
4	其他	89,214	28%	-	其他	49,381	15%	-
	銷貨淨額	313,650	100%	-	銷貨淨額	331,421	100%	-

增減變動說明：

客戶 A 佔比增加係因客戶需求增加所致。

客戶 B 佔比減少係因客戶需求減少所致。

客戶 C 佔比增加係因客戶需求增加所致。

- 三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率：

單位：人；%

年度		113年	114年	115年4月22日
員工人數	直接員工	13	17	18
	間接員工	41	62	63
	研發人員	63	75	78
	合計	117	154	159
平均年歲		39.7	38.18	37.92
平均服務年資(年)		4.6	4.62	4.4
學歷分佈比率(%)	博士	3	3	3
	碩士	29	55	56
	大學(專)	62	87	90
	高中(含以下)	6	9	10

四、環保支出資訊

1. 依法令規定，應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員者，其申領、繳納或設立情形之說明：

- (1) 本公司屬於組裝及系統整合生產模式，並無污染廢液及製程廢水，故不適用本法規。
- (2) 本公司產品包材如木箱及廢棄棧板等均由合格廢棄物廠商資源回收處理。
2. 防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益：不適用。
3. 最近二年度及截至年報刊印日止，公司改善環境污染之經過，其有污染糾紛事件者，並應說明其處理經過：不適用。
4. 最近二年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所受損失(包括賠償)，處分之總額，並揭露其未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出(包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實)：不適用。
5. 目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來二年度預計之重大環保資本支出：不適用。

五、勞資關係

(一) 列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

1. 員工福利措施及實施狀況

除依法令規定之勞工保險、全民健康保險外，本公司另提供員工團體保險、員工結婚、生育補助及喪葬奠儀等，並提供員工咖啡茶飲，以照顧員工之生活。本公司亦成立職工福利委員會，統籌員工各項福利及補助等事務。

2. 員工進修及訓練

本公司訂有教育訓練作業程序，幫助新進員工了解工作內容及作業環境，並於員工工作時給予相關之指導，培養員工專業知識及技能，使其發揮其職能並增加工作效率，提供員工良好學習成長之工作環境。

3. 退休制度與實施狀況

本公司依勞工退休金條例之勞退新制，本公司員工每月按薪資總額提撥6%退休金並存入勞工保險局個人退休金專戶。外國籍員工則適用勞退舊制。

4. 勞資間之協議情形

本公司之各項規定皆依勞動基準法為遵循準則，對於員工意見極為重視，採雙向及開放方式與員工進行溝通，並定期舉辦勞資會議，以期勞資雙方維

持良好和諧之互動關係。

5. 各項員工權益維護措施情形

本公司訂有相關管理辦法及制度，內容明訂員工權利義務及福利項目，並定期檢討修訂福利內容，以維護所有員工權益。

(二) 列明最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實

本公司自成立迄今，勞資關係和諧，視員工為最大資產，秉持著人性化管理，維持勞資雙方良好互動關係，未有重大勞資糾紛之情事發生。

六、資通安全管理

(一) 敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等：

1. 資通安全風險管理架構

- (1) 本公司設置資訊之權責單位，該單位設置資訊主管，與專業資訊人員，負責訂定企業內部資訊安全政策、規劃暨執行資訊安全防護與資安政策推動與落實
- (2) 公司稽核室為資訊安全監理之督導單位，該室設置稽核主管/專職稽核人員，負責督導內部資安執行狀況，若發現缺失，即刻要求受查單位提出相關改善計畫和作為，定期追蹤改善成效，以降低內部資安風險。
- (3) 組織架構之運作模式採取稽核與改善之循環式(PDCA)的管理，以確保目標之達成且持續改善。

2. 資通安全政策

本公司實施之資訊安全與管理措施包含如下：

- (1) 權限管理 (人員帳號與權限授權管理)
 - A. 人員帳號權限管理與審核。
 - B. 人員帳號權限不定期盤點。
 - C. 人員密碼定期更換。

D. 人員離職立即取消帳號和所有權限。

E. 密碼禁止與任何人分享，包括同事與上司。

(2) 存取管理 (人員存取部資源、及資料傳輸控制)

A. 內/外部存取資料，需有正確的帳號、密碼。

B. 無線網路連線需有密碼。

C. 廠商或客戶於公司內部，不得使用公司內部有線/無線網路；若有實際需求，只能使用 Guest 無線網路，杜絕於公司內部網路之外。

D. 遠端連線存取管控，需有正確的帳號、密碼，並經適當的允許。

E. 使用者切勿從不安全的、公共網路連結到公司內部網路。

(3) 威脅管理 (病毒、入侵防護)

A. 電腦定時更新相關病毒碼及掃毒引擎，並且定期掃描。

B. 防火牆入侵防護/病毒防護/惡意程式防護。

C. 透過防火牆過濾對連外網頁。

D. 使用具合法版權軟體，禁止下載來路不明之軟體。

E. 每年至少執行一次社交工程演練，灌輸員工正確資安觀念。

(4) 系統管理 (系統與服務中斷預防)

A. 系統/網路可用狀態監控。

B. 資料本地/異地備份、備援措施。

C. 每年至少一次災害復原演練。

3. 本公司具體管理方案及投入資通安全管理之資源，包含以下面向：

(1) 制度規範的制定：

訂定公司資訊安全管理措施，規範人員對於資訊作業的行為。

(2) 資安宣導與訓練：

不定期於信件或集會中，持續對人員進行資訊安全宣導與教育訓練，藉以提昇同仁對於資安意識和資安相關專業知識。

(3) 資訊系統的防護：

建置資訊安全管理系統，並持續提升與汰換軟、硬體資訊設施，以符合資安管控的需求。

(4) 資安稽核與改善：

本公司稽核部門不定時稽核資訊安全，針對資安風險加以評估，適切提出控制建議，資訊安全部依此作調整與改善，並針對評估後之高風險系統進行對應的管理機制，以利控管資安風險。

(二) 列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情形。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
協助中小型事業疫後振興專案	台灣中小企業銀行	114/02/11-119/02/11	銀行授信合約	無
協助中小企業低碳化智慧化轉型發展與納管工廠及特定工廠基礎設施優化專案	台灣中小企業銀行	114/02/25-119/02/25	銀行授信合約	無
授信契約	台灣中小企業銀行	114/07/24-115/07/24	銀行授信合約	無
週轉金貸款契約	台灣中小企業銀行	114/07/24-115/07/24	銀行授信合約	無
中長期貸款契約	台灣中小企業銀行	114/07/29-134/07/29	銀行授信合約	購屋貸款
授信契約	兆豐國際商業銀行	115/02/23-115/10/20	銀行授信合約	無
中長期授信合約	兆豐國際商業銀行	115/02/23-121/12/31	銀行授信合約	無
一般週轉金借款契約	彰化商業銀行	115/03/26-116/03/31	銀行授信合約	無
週轉金貸款契約	台灣中小企業銀行	115/04/21-116/04/21	銀行授信合約	訂單借款
房屋租賃契約	台元紡織(股)公司	113/05/01-116/04/30	廠房租賃	無
房屋買賣契約	文生開發股份有限公司	114/5/23簽約	廠房買賣	無
主採購契約	A公司	2023/7/24 - 2028/7/23	設備採購	最惠客戶條款與終止條款
房屋租賃契約	台元紡織(股)公司	113/05/01-116/04/30	廠房租賃	無
房屋租賃契約	台元紡織(股)公司	113/09/01-115/08/31	廠房租賃	無
房屋租賃契約	台元紡織(股)公司	113/06/01-116/05/31	廠房租賃	無
房屋租賃契約	台元紡織(股)公司	115/04/01-117/03/31	廠房租賃	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

1.財務狀況-國際會計準則(合併)

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	113 年度	114 年度	增(減)變動	
			金額	%
流動資產	524,792	772,889	248,097	47.28%
不動產、廠房及設備	240,967	317,847	76,880	31.90%
無形資產	51,766	9,962	(41,804)	(80.76%)
其他非流動資產	28,314	16,222	(12,092)	(42.71%)
資產總額	845,839	1,116,920	271,081	32.05%
流動負債	431,281	474,561	43,280	10.04%
非流動負債	57,270	102,140	44,870	78.35%
負債總額	488,551	576,701	88,150	18.04%
普通股股本	395,620	478,650	83,030	20.99%
資本公積	83,799	285,637	201,838	240.86%
待彌補虧損	(122,228)	(214,736)	(92,508)	(75.68%)
其他權益	97	(9,332)	(9,429)	(9,720.62%)
權益總額	357,288	540,219	182,931	51.20%
1.變動原因說明:(變動達 20%以上，且變動金額達新台幣一千萬元者) 流動資產增加主要係銀行存款及存貨增加所致。 不動產、廠房及設備增加主要係購置辦公室及裝修增加所致。 無形資產減少主要係變更耐用年限攤提增加所致。 其他非流動資產減少主要係使用權資產減少所致。 非流動負債增加主要係長期借款增加所致。 普通股股本及資本公積增加主要係現增及發行限制員工權利新股所致。 待彌補虧損增加主要係本年度虧損增加所致。 2.影響重大者之未來因應計畫:無。				

註：上列各年度均經會計師查核簽證。

2.財務狀況-國際會計準則(個體)

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	113 年度	114 年度	增(減)變動	
			金額	%
流動資產	536,882	805,207	268,325	49.98%
不動產、廠房及設備	237,491	303,953	66,462	27.99%
無形資產	51,766	9,962	(41,804)	(80.76%)
其他非流動資產	26,255	14,808	(11,447)	(43.60%)
資產總額	852,394	1,133,930	281,536	33.03%
流動負債	430,132	476,158	46,026	10.70%
非流動負債	64,974	117,553	52,579	80.92%
負債總額	495,106	593,711	98,605	19.92%
普通股股本	395,620	478,650	83,030	20.99%
資本公積	83,799	285,637	201,838	240.86%
待彌補虧損	(122,228)	(214,736)	(92,508)	(75.68%)
其他權益	97	(9,332)	(9,429)	(9,720.62%)
權益總額	357,288	540,219	182,931	51.20%
1.變動原因說明:(變動達 20%以上，且變動金額達新台幣一千萬元者) 流動資產增加主要係銀行存款及存貨增加所致。 不動產、廠房及設備增加主要係購置辦公室及裝修增加所致。 無形資產減少主要係變更耐用年限攤提增加所致。 其他非流動資產減少主要係使用權資產減少所致。 非流動負債增加主要係長期借款增加所致。 普通股股本及資本公積增加主要係現增及發行限制員工權利新股所致。 待彌補虧損增加主要係本年度虧損增加所致。 2.影響重大者之未來因應計畫:無。				

註：上列各年度均經會計師查核簽證。

二、財務績效

1.財務績效-國際會計準則(合併)

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	113 年度	114 年度	增(減)變動	
			金額	%
營業收入淨額	313,650	331,421	17,771	5.67%
營業成本	(187,931)	(177,897)	(10,034)	(5.34%)
營業毛利	125,719	153,524	27,805	22.12%
營業費用	(271,214)	(329,505)	58,291	21.49%
營業淨利(損)	(145,495)	(175,981)	(30,486)	(20.95%)
營業外收入及支出	23,265	(385)	(23,650)	(101.65%)
稅前淨利(損)	(122,230)	(176,366)	(54,136)	(44.29%)
本期淨利(損)	(122,228)	(176,307)	(54,079)	(44.24%)
其他綜合損益淨額	315	134	(181)	(57.46%)
本期綜合損益總額	(121,913)	(176,173)	(54,260)	(44.51%)
1.變動原因說明:(變動達 20%以上)				
營業毛利增加主要係因營收增加及成本下降所致。				
營業費用增加及營業淨利減少主要係為維持技術領先以進入高毛利市場，持續高強度的研發費用之投入及為進入資本市場以增進籌資與提升營運能力，致營業費用增加，營業淨利隨之減少。				
營業外收入及支出減少主要係因補助收入減少及利息費用增加所致。				
稅前淨利減少主要係因營業費用增加所致。				
2.對未來財務業務之可能影響及因應計畫:無。				

註：上列各年度均經會計師查核簽證。

2.財務績效-國際會計準則(個體)

單位：新台幣千元

年度 項目	113 年度	114 年度	增(減)變動	
			金額	%
營業收入淨額	300,019	352,736	52,717	17.57%
營業成本	(177,232)	(202,847)	25,615	14.45%
營業毛利	122,787	149,889	27,102	22.07%
營業費用	(268,321)	(327,635)	59,314	22.11%
營業淨利(損)	(145,534)	(177,746)	(32,212)	(22.13%)
營業外收入及支出	23,306	1,439	(21,867)	(93.83%)
稅前淨利(損)	(122,228)	(176,307)	(54,079)	(44.24%)
本期淨利(損)	(122,228)	(176,307)	(54,079)	(44.24%)
其他綜合損益淨額	315	134	(181)	(57.46%)
本期綜合損益總額	(121,913)	(176,173)	(54,260)	(44.51%)
1.變動原因說明:(變動達 20%以上)				
營業毛利增加主要係因營收增加所致。				
營業費用增加及營業淨利減少主要係為維持技術領先以進入高毛利市場，持續高強度的研發費用之投入及為進入資本市場以增進籌資與提升營運能力，致營業費用增加，營業淨利隨之減少。				
營業外收入及支出減少主要係因補助收入減少及利息費用增加所致。				
稅前淨利減少主要係因營業費用增加所致。				
2.對未來財務業務之可能影響及因應計畫:無。				

註：上列各年度均經會計師查核簽證。

三、現金流量(合併)：

單位：新臺幣千元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流量	全年來自投資活動淨現金流量	全年來自融資活動淨現金流量	現金剩餘數額 (含匯率影響數)	預計現金不足額之補救措施	
					投資計畫	理財計畫
61,574	(197,121)	(97,402)	449,703	216,206	—	—

(1)本年度現金流量變動情形分析：

營業活動：主要係因本期虧損所致。

投資活動：主要係本期購置不動產、廠房及設備。

融資活動：主要係現金增資及員工執行認股權及銀行借款增加所致。

(2)流動性不足之改善計畫：本公司資金尚屬充裕，無流動性不足之虞。

(3)未來一年現金流動性分析：不適用。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無此情形。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

1.轉投資政策：

本公司轉投資是基於中國市場需求並提供當地客戶即時售後服務之需，考量營運成長需求及未來發展而進行轉投資，對轉投資事業之組織型態、設置地點、市場狀況等項目進行評估，作為投資決策之依據，並由相關執行部門遵循內部控制「投資循環」及「取得或處分資產處理程序」等辦法執行投資相關事宜。

2.最近年度轉投資獲利或損失之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

本公司因應大陸客戶需求於 111 年度以 100%全資設立家中國子公司政應(上海)科技有限公司負責代銷及售後服務等，惟已於內部控制制度中訂定對子公司之監督與管理作業，以定期監督子公司營運狀況。

114 年 12 月 31 日;單位:新台幣千元

轉投資事業	投資金額(註 1)		政策	被投資公司 本期(損)益	獲利或虧損 主要原因	改善計畫
	本期期末	去年年底				
政應(上海)科技有限公司	4,836	4,836	開發中國市場	2,905	設立目的為開發中國市場並提供售後服務之需求，因中國市場需求增加，故產生小額獲利。	雖有小額獲利，後續仍將積極開發在地客戶及擴展業務。

註 1：原始投資金額之原幣數為美金 15 萬元，本期期末原始投資金額之原幣數為美金 15 萬元。

六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項：

(一) 風險因素：分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項：

1. 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

(1) 利率變動：

本公司營運以自有資金為主，截至 113 年及 114 年底與金融機構借款餘額分別為 307,320 千元及 417,200 千元，113 年度及 114 年度利息費用為 8,161 千元及 10,569 千元，分別佔稅前淨損比率為 6.68%及 5.99%。本公司與往來銀行保持良好關係，未來若有短期資金需求，亦可透過與銀行議價取得較佳利率水準，預計未來利率變動對本公司整體營運不致有重大影響。

(2) 匯率變動：

本公司功能性貨幣為新台幣，本公司 113 年度及 114 年度淨外幣兌換利益(損失)分別為 6,669 千元及(1,827)千元。雖本公司有從事外幣計價之交易，產生匯率變動曝險，但財會單位平常積極蒐集匯率變化資訊，與主要往來銀行保持聯繫隨時掌握匯率變動趨勢，故匯率變動對本公司損益尚不致有重大影響。

匯率變動對本公司損益之影響主要為外幣資產持有部位隨匯率波動產生之曝險。為因應匯率波動風險，本公司除以外幣支付國外採購款項，形成部分自然避險效果外，亦密切關注匯率變化與市場趨勢，持續蒐集主要國際貨幣之匯率資訊。同時，本公司與金融機構保持良好互動關係，藉以取得更即時、多元的外匯市場訊息與較具競爭力的報價條件，以有效降低匯率波動所帶來之財務風險。

(3) 通貨膨脹情形：

近年來全球整體經濟環境呈現通貨膨脹逐步升高之趨勢，本公司與供應商及客戶保持密切且良好之互動關係，並密切關注原物料價格波動及通貨膨脹情形，適時調整採購及訂價策略，以降低通貨膨脹之影響，故通貨膨脹對本公司損益尚不致有重大影響。

2. 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

(1) 從事高風險、高槓桿投資之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司秉持著以誠信為最高原則，專注於本業之經營，重視技術之研發及業務拓展，此外，各政策之制定以穩健經營為基礎，並以財務健全發展為前提，故本公司最近年度及截至年報刊印日止並無從事高風險、高槓桿之投資。

(2) 從事資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司訂有「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」，相關作業程序業經股東會決議通過，為本公司執行相關交易之依據。最近年度及截至年報刊印日止，並無資金貸與他人、為他人背書保證及從事衍生性商品交易之情事。

3. 未來研發計畫及預計投入之研發費用

(1) 未來研發計畫：

本公司研發計畫主要是依據市場產品需求，配合營運規劃及產業發展方向，研發出具有市場性、未來性的產品及技術。主要開發方向如下：

A. 半導體檢測設備

(a) 8/12 吋晶圓檢查設備：為因應先進封裝 RDL 由 2/2 μm 線路至 1/1 μm 線路細線化以及凸塊由 25/10 μm (直徑/高度)走向 10/5 μm (直徑/高度)，檢查設備需顧及檢出率以及產能，勢必提昇 2D、3D 光學模組性能以及軟體計算能力。本公司俱備光、機、電、軟研發能力，除了能擴展現有檢查設備的市佔率，在面對未來客戶的需求更能及早一步準備完成，協同客戶一起驗證高階產品改善良率。

(b) Panel-Level 檢查設備：針對大面積基板之檢查設備，其所需的檢查能力需求與 12 吋晶圓相同，但設備變大後所需的硬體精度仍需維持，此為 Panel-Level 檢查設備的困難點。本公司以 12 吋晶圓檢查設備數年的經驗為基礎，進而開發 Panel-Level 檢查設備以符合市場及客戶需求，協助客戶提昇良率並降低成本。

(c) 4 至 6 吋無圖形晶圓檢查設備：針對矽光子(光通)的需求，晶圓表面的缺陷需要被控制，而且 0.2 μm 以上的缺陷尺寸需要被明確分規，此技術多掌握在國外的設備商手中，本公司自行開發的光學系統(Nano Detection System, NDS) 配合客戶的驗證，協助客戶在矽光子製程中提昇良率並降低成本。

B. Micro LED 檢測設備

(a) 4/6 吋 Micro LED 表面檢查設備：Micro LED 號稱終極顯示器，本公司 Micro LED 檢查設備已經通過少數進入量產階段的客戶驗證。面對未來的挑戰，為了協助客戶真正進入消費者市場，Micro LED 的生產成本必需降低 95%，亦即 Micro LED 晶粒將會小於 15 μm x 15 μm 甚至更小，因此檢測設備將會是關鍵因素，用以提升整體良率使生產成本有效下降，本公司檢查設備面對的挑戰將是整體設備性能的積極提昇，而本公司開發的 Micro LED 表面檢查設備已經具備 2 年內檢測能力的需求，極具競爭力。

(b) 4/6 吋 Micro LED 光致發光 (photoluminescence，以下簡稱 PL)檢查設備：由於晶粒已經小到無法使用傳統電致發光 (Electroluminescence，以下簡稱 EL)方式來辨別晶粒的好壞，故本公司開發 PL 檢查設備，經由光學的高精度對位，可以準確且快速的量測到每一顆晶粒的 PL 狀態，進而整合表面檢查與 PL 檢查的結果，避免巨量轉移後的修復成本，對於客戶提升良率、降低成本將有極大的助益。

(c) G3.5/ G4.5 代面板 Micro LED 表面檢查設備：Micro LED 目前主要的應用為大型顯示器 (Public Information Display，簡稱 PID、Television)、穿戴裝置(Watch)以及 AR/VR，而在大型顯示器這部份，對傳統面板廠而言是非常有優勢的，台灣的兩大面板廠早已經規劃將原本 G3.5/G4.5 代線轉換成 Micro LED 產線，本公司憑藉著在 4/6 吋 Micro LED 表面檢查設備的技術能力及優勢，順勢切入 G3.5/ G4.5 代面板 Micro LED 表面檢查設備，協助客戶量產獲取效益，並取得在 Micro LED 電視的領先地位。

(2) 預計投入之研發費用：

本公司 114 年度投入之研發費用為新台幣 161,888 千元，未來將投入之研發費用依新產品及技術開發進度編列。隨著營業規模成長，為加速研發速度，不排除逐步提高研發費用，以支應未來研發計畫，除持續延攬擁有豐富經驗及創造力之研發人才，亦將增購研發所需之相關軟硬體，以提升研發能力，進而增加本公司之競爭優勢。本公司將依各研發專案進度逐年編列研發預算，除攤銷費用外，預計 115 年度投入之研發費用將持續成長。

4. 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司營運均遵照國內外相關法令規定辦理，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情形，必要時諮詢相關專業人士，以充份掌握國內外政策與法令變動，蒐集相關資訊提供經營階層決策參考，因應市場環境之變化適時調整本公司相關營運策略。本公司最近年度及截至年報刊印日止，尚無發生國內外重要政策及法律變動而對本公司財務業務有重大影響之情事。

5. 科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

本公司致力於創新及研發，除著力於提升研發能量，並積極拓展市場及相關應用領域，以領導產業脈動、追求企業永續經營。設有專職人員隨時掌握相

關產業之科技改變情形及產業變化趨勢，行銷、業務及研發人員隨時留意所處產業相關之市場變化、科技改變及技術發展，以迅速掌握產業動態，並評估對公司未來發展及對財務業務之影響，做好相關之規劃及採取必要因應措施。

此外，因應科技的進步，公司已建立資訊安全管理辦法，由資訊部統籌並執行，包含宣導資料安全訊息及提升員工資安意識，以維護整體資訊業務正常運作及機密資料的隱密性，故科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務並未有重大影響。

6. 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司以「創新技術提供卓越的製程控制解決方案，給予客戶高價值的體驗，使 CMI 成為最尊敬的國際品牌」為使命，聚焦先進封裝、Micro LED、化合物半導體市場，期盼能夠達成見微知著、精益求精、脫穎而出、共創多贏的格局，追求企業永續經營及發展。本公司自成立以來即遵守相關法令規定，積極強化內部管理與績效，也善盡企業之社會義務，落實公司治理及社會責任，建立並維持良好的企業形象，獲得廠商及客戶的長期信賴與認同。本公司一向秉持專業、誠信的企業精神，並持續強化本公司日常營運管理，讓公司的制度與同仁，均有足夠的能力應變可能的企業危機，降低該風險對公司營運之影響。最近年度及截至年報刊印日止，本公司未因企業形象改變而衍生相關企業危機之情事，未來亦將持續落實公司治理要求，適時諮詢專家意見，以降低該風險對公司營運之影響，並擬定相關因應措施如下：

- (1)不斷優化產品與服務表現，積極投入公益事務，以展現企業對社會責任的重視與良好形象。
- (2)透過規律性揭露營運成果與發展趨勢，建立透明資訊管道，降低外界誤判風險，進一步提升企業品牌信任度。
- (3)預先擬定各類潛在風險的處理對策，當事件發生時能即時反應，有效控管損害範圍，以守護企業聲譽。
- (4)透過教育訓練提升團隊面對突發事件的應對技巧，讓員工在企業處於壓力或形象風險時，能快速協作並採取有效行動。
- (5)主動經營媒體互動，培養穩定互信的合作網絡，有助於資訊傳播與形象經營。

7. 進行購併之預期效益、可能風險及因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無進行併購之情事。

8. 擴充廠房之預計效益、可能風險及因應措施

因應半導體先進封裝、Micro LED 及化合物半導體客戶訂單的需求，本公司台元廠之量體規模將無法滿足設備生產之需。考量中長期營運規劃，本公司在充分評估後，於 113 年 5 月開始租用台元園區 306 廠房，規劃建構本公司最新生產基地。本公司原則以分期、分階段，公司財務可負擔，最小風險下擴充廠房及產能，同時兼顧公司穩健成長與滿足客戶產能需求，對本公司營運及財務業務均有正面之助益。

9. 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

(1) 進貨集中面臨之風險及因應措施：

本公司主要原料大多具備兩家以上之供應商，加工廠商則以國內企業為主，供貨來源眾多，個別廠商並無不可取代性，且本公司採分散採購原則，並與供應廠商皆維持長久穩定之合作關係，以避免因不可抗力之因素，而造成貨源不足之風險。因此，本公司尚無進貨集中之風險。

(2) 銷貨集中面臨之風險及因應措施：

本公司 113 年度及 114 年度，銷售予單一客戶之金額占銷貨淨額最高之比重分別為 50.76%及 66.50%。本公司在半導體先進封裝檢測量測設備領域的優異技術與實務經驗，深獲客戶肯定，因應客戶產線建置，故銷售集中情形較為顯著。將持續穩定提供客戶相關產品與服務，更將積極開發新市場與新客戶，並與原有客戶保持良好的合作關係，利用本公司技術化的優勢，分散訂單來源，以降低銷貨集中所產生之風險。

10. 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施

最近年度及截至年報刊印日止，本公司董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，並無因股權大量移轉或更換對本公司之營運造成重大影響之情事。

11. 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無經營權改變之情形發生。

12. 其他重要風險及因應措施：無。

(二) 訴訟或非訟事件

1. 公司最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：無。
2. 公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無。
3. 公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至年報刊印日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司目前辦理情形：無。

(三) 公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東最近二年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難或喪失債信情事，應列明其對公司財務狀況之影響：無。

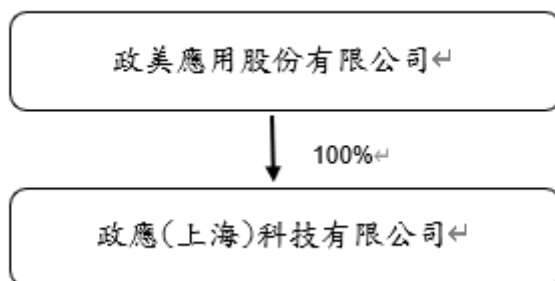
(四) 其他重要風險及因應措施：無。

七、 其他重要事項：無

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

(一) 關係企業組織圖



註：本公司於民國 111 年 08 月 12 日經董事會決議，以美金 15 萬元於中國大陸上海設立子公司政應(上海)科技有限公司，投資持股比例為 100%，該子公司已於民國 111 年 09 月 23 日完成設立登記，主要目的為提供客戶即時及在地化服務。

(二) 關係企業基本資料

單位：新臺幣千元

公司名稱	設立日期	所在地址	實收資本額	主要營業項目
政應(上海)科技有限公司	111/9/23	上海市嘉定區嘉定工業區叶城路 912 號 JT17745 室	USD 150,000 元	技術服務、電子產品買賣、光學及一般儀器買賣。

(三)推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

(四)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：請參閱關係企業基本資料

(五)關係企業董事、監察人及總經理資料

114 年 12 月 31 日 單位：千股；%

公司名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
政應(上海)科技有限公司	董事長兼法定代表人	林佳龍	—	100.00
政應(上海)科技有限公司	董事	蔡政道	—	—
政應(上海)科技有限公司	董事	黃朝瑜		
政應(上海)科技有限公司	監察人	陳壽康		

(六)關係企業營運概況

114 年 12 月 31 日 單位：新臺幣千元

公司名稱	資本額	資產 總值	負債 總值	淨值	營業 收入	營業 利益 (損失)	本期 損益 (稅後)	每股 盈餘 (元)
政應(上海)科技有限公司	4,836	73,356	62,482	10,874	33,372	1,950	2,905	

(七)關係企業合併財務報表：不適用。

(八)關係報告書：不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

五、符合一定條件之公司，其年報除前項應記載事項外，並應以專章方式記載經董事會決議通過之永續相關財務資訊：本公司為實收資本額未達 50 億元之興櫃公司，故不適用。

內部控制制度審查 會計師合理確信報告

政美應用股份有限公司 公鑒：

政美應用股份有限公司與外部財務報導和保障資產安全有關之內部控制制度民國 113 年 12 月 31 日之設計及執行情形及於民國 114 年 6 月 20 日所出具謂經評估其與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度，於民國 113 年 12 月 31 日係有效設計及執行之聲明書，業經本會計師執行必要程序竣事。

確信標的、確信標的資訊與適用基準

本確信案件之標的及標的資訊分別為政美應用股份有限公司與外部財務報導和保障資產安全有關之內部控制制度民國 113 年 12 月 31 日之設計及執行情形及政美應用股份有限公司於民國 114 年 6 月 20 日所出具謂經評估其與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度，於民國 113 年 12 月 31 日係有效設計及執行之聲明書，詳附件。

用以衡量或評估上開確信標的及標的資訊之適用基準係「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之內部控制制度有效性判斷項目。

先天限制

由於任何內部控制制度均有其先天上之限制，故政美應用股份有限公司上述內部控制制度仍可能未能預防或偵測出業已發生之錯誤或舞弊。此外，未來之環境可能變遷，遵循內部控制制度之程度亦可能降低，故在本期有效之內部控制制度，並不表示在未來亦必有效。

管理階層之責任

管理階層之責任係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及相關法令規章建立內部控制制度，且隨時檢討，以維持內部控制制度之設計及執行持續有效，並於評估其有效性後，據以出具內部控制制度聲明書。

會計師之責任

本會計師之責任係依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及確信準則 3000 號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」對確信標的及標的資訊執行必要程序以取得合理確信，並對確信標的及標的資訊在所有重大方面是否遵循適用基準及是否允當表達作成結論。

獨立性及品質管理規範

本會計師及所隸屬會計師事務所已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性及其他道德規範之規定，該規範之基本原則為正直、公正客觀、專業能力及專業上應有之注意、保密及專業行為。此外，本會計師所隸屬會計師事務所遵循品質管理準則 1 號「會計師事務所之品質管理」，該品質管理準則規定會計師事務所設計、付諸實行及執行品質管理制度，包含與遵循職業道德規範、專業準則及適用之法令規範相關之政策或程序。

所執执行程序之彙總說明

本會計師係基於專業判斷規劃及執行必要程序，以獲取相關標的及標的資訊之證據。所執行之程序包括瞭解公司內部控制制度、評估管理階層評估整體內部控制制度有效性之過程、測試及評估其與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度設計及執行之有效性，以及本會計師認為必要之其他確信程序。

確信結論

依本會計師意見，政美應用股份有限公司與外部財務報導和保障資產安全有關之內部控制制度民國 113 年 12 月 31 日之設計及執行，在所有重大方面已遵循「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之內部控制制度有效性判斷項目可維持有效性；政美應用股份有限公司於民國 114 年 6 月 20 日所出具謂經評估其與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度係有效設計及執行之聲明書，在所有重大方面係屬允當表達。

強調事項

如附件第五項聲明所述，政美應用股份有限公司對於其符合相關規範暨法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計與執行係屬有效之聲明係包含業已依照「公開發行公司取得或處分資產處理準則」、「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」、「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及有關法令規定，針對取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人之管理、為他人背書或提供保證之管理、關係人交易之管理、財務報表編製流程之管理及對子公司之監督與管理訂定相關作業程序。本會計師未因此而修正確信結論。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 陳 明 煒

陳明煒



會計師 蔡 美 貞

蔡美貞



中 華 民 國 1 1 4 年 6 月 2 0 日

Cheng Mei Instrument Technology Co., Ltd.

政美應用股份有限公司



董事長：蔡政道

